

半导体

证券研究报告 2024 年 03 月 05 日

投资评级

行业评级 强于大市(维持评级) **上次评级** 强于大市

作者

潘暕 分析师

SAC 执业证书编号: S1110517070005 panjian@tfzq.com

骆奕扬 分析师

SAC 执业证书编号: S1110521050001 luoyiyang@tfzq.com

星如莹 分析师 840 执业证书编号,\$11105211

SAC 执业证书编号: S1110521110002 chengruying@tfzq.com

行业走势图



资料来源:聚源数据

相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:英伟达业绩 超预期,HBM 需求旺盛,华为 P70 值 得期待》 2024-02-27
- 2 《半导体-行业研究周报:中芯华虹将 发布 4Q23 业绩,看好晶圆代工周期复 苏》 2024-02-06
- 3 《半导体-行业研究周报:三星 S24 海外预定量超预期, AI 有望拉动半导体复苏》 2024-01-29

1

三星智能戒指亮相 MWC, 华为 P70 产业链主题机会值得把握

一周行情概览:上周半导体行情优于所有主要指数,领跑趋势明显。上周创业板指数上涨 3.74%,上证综指上涨 0.74%,深证综指上涨 4.03%,中小板指上涨 4.37%,万得全 A 上涨 2.42%,申万半导体行业指数上涨 8.44%,半导体行业指数行情优于所有主要指数。半导体各细分板块涨幅明显,其他板块领涨,半导体制造涨幅最低。半导体细分板块中,IC 设计板块上周上涨 7.9%,半导体材料板块上周上涨 5.5%,分立器件板块上周上涨 8.0%,半导体设备板块上周上涨 10.1%,封测板块上周上涨 5.7%,半导体制造板块上周上涨 10.3%。

行业周期当前处于相对底部区间,我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度,优先复苏的品种财务报表有望优先改善,长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位,经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面,人工智能/卫星通讯/MR 将是较大的产业趋势,产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。

三星智能戒指 Galaxy Ring 首次在 MWC 2024 展示,AI 或重燃可穿戴商机,看好大厂入局后智能戒指渗透率提升。三星在 MWC 2024 首次展示 Galaxy Ring,产品内圈具有多个传感器,可以监测心率、血氧饱和度、步数等健康数据,产品预计年内面世。作为新一代智能穿戴设备,智能戒指的产品形态、重量比普通戒指的平均重量更轻,舒适度优于现有腕上智能设备。由于手指处的皮肤透光性更好、设备佩戴更贴合,且血液、血流信息更加丰富,智能戒指具备较高的生物信息采集效率,是健康监测的较佳选择。除健康监测功能外,苹果、三星的有关专利表明其有望成为空间交互传感器和现有智能设备协同。智能戒指市场目前仍处于萌芽期,我们认为三星的入局有望加速市场教育,加速产品渗透率提升。

华为 P70 预计发售在即,产业链或迎来双击,建议关注。华为 P70 系列预计发售在即(P60 于 23 年 3 月末发布),据媒体报道,新机在影像/卫星通讯/外观等领域有升级,值得期待。2023 年 Mate60 系列发售以来,华为手机销量持续亮眼,Counter Point 数据显示,2024 年前两周,华为手机在中国市场的销量份额重回第一,华为手机产业链预计随着华为手机出货量提升,将有望体现出营收业绩双增,我们认为考虑到华为品牌"王者归来",在手机品牌中结构性增长,相关产业链有望迎来双击行情

供给侧,半导体先进封装材料需求旺盛,AI 拉动叠加国产替代,2024 年有望较快速增长。2023 年,半导体材料市场整体呈现出了下滑的态势,主要是由于半导体行业增长整体放缓以及晶圆厂产能利用率下降。进入 2024 年,受到新产能建设节奏影响(例如和远气体,新产能于 24 年 2 月 27 日公告取得试产通知书),预计板块迎来增长之年。其中半导体先进封装受到下游 AI 需求拉动,国内先进封装产能(如长电先进/盛合京微等)扩产速度预计快于传统封装,先进封装材料考虑到国产替代的趋势,预计 2024 年有望较快速增长。

建议关注:

- 1)半导体设计: 汇顶科技/晶晨股份/瑞芯微/全志科技/恒玄科技/乐鑫科技/寒武纪/龙芯中科/海光信息(天风计算机覆盖)/江波龙(天风计算机联合覆盖)/北京君正/富瀚微/普冉股份/东芯股份/澜起科技/聚辰股份/帝奥微/纳芯微/圣邦股份/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/思瑞浦/扬杰科技/新洁能/兆易创新/韦尔股份/思特威/艾为电子/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电/希荻微
- 2) 半导体材料设备零部件:艾森股份/正帆科技(天风机械联合覆盖)/江丰电子/北方华创/新莱应材(天风机械覆盖)/华亚智能/英杰电气(天风电新覆盖)/富创精密/明志科技/汉钟精机(天风机械覆盖);雅克科技/沪硅产业/华峰测控(天风机械覆盖)/上海新阳/中微公司/精测电子(天风机械联合覆盖)/长川科技(天风机械覆盖)/鼎龙股份(天风化工联合覆盖)/安集科技/拓荆科技(天风机械联合覆盖)/盛美上海/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体(天风化工覆盖)/凯美特气/和远气体(天风化工联合覆盖)
- 3) IDM 代工封测:时代电气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电;华虹公司/中芯国际/长电科技/通富微电
- 4)卫星产业链:电科芯片/华力创通/复旦微电/北斗星通/利扬芯片 风险提示:地缘政治带来的不可预测风险,需求复苏不及预期,技术迭代不及预期



内容目录

1. 把:	本周观点(02/26-03/01): 三星智能戒指亮相 MWC,华为 P70 产业链主题机会值 握	_
2.	本周(02/26-03/01)重要事件及行情更新	5
3.	半导体产业宏观数据:半导体销售恢复中高速增长,存储成关键	7
4.	芯片交期及库存:全球芯片交期持续改善,需求复苏下行业重回上升周期	9
5.	产业链各环节景气度:	.14
	5.1. 设计:库存去化效益显现,需求复苏有望带动基本面持续向好	. 14
	5.1.1. 存储:周期已触底反弹,本周 NAND Flash Wafer 和 DDR 资源价格上涨	. 14
	5.1.2. 数字芯片:高通发布 MR 设备芯片 XR2+Gen 2,重点关注 XR 市场相关标	
	5.1.3. 模拟芯片:国际大厂 23Q4 收入同比减少,24Q1 展望营收或环比继续下	行
	5.1.4. 功率器件: 国际功率大厂分部门营收受到下游需求分化明显	. 23
	5.1.5. 射频芯片: 海外龙头 Q4 普遍出现稼动率提升、毛利率和营收同比增长.	. 25
	5.1.6. CIS: 消费电子景气回暖及补库拉动业绩回升,三星 CIS 24 年有望开启涨	
	5.2. 代工:先进制程需求增长,台积电计划 2024 年底 3nm 产能提升至 80%	. 25
	5.3. 封测: 先进封装需求供不应求,行业复苏趋势明显	. 27
	5.4. 设备材料零部件:1月,可统计设备中标数量 27 台,招标数量 27 台	. 28
	5.4.1. 设备及零部件中标情况: 1月可统计设备中标数量同比出现下滑	. 28
	5.4.2. 设备招标情况: 1月可统计设备招标数量 27台,同比-46%	. 32
	5.5. 分销商:整体分销市场需求逐步回升,2024年行业复苏可期	. 33
6.	终端应用:看好消费电子复苏,关注元宇宙发展走势	.33
	6.1. 消费电子:1月 AI 成 PC 市场新增长点,关注苹果 MR 新品对供应链影响	. 33
	6.2. 新能源汽车:强者恒强,行业进入加速洗牌期	. 34
	6.3. 工控:工控行业订单低迷,国产品牌市占率提升	. 35
	6.4. 光伏: 光伏行业市场供大于求,库存去化仍在持续	. 35
	6.5. 储能: 行业库存问题仍存在,终端需求维持乐观预期	. 35
	6.6. 服务器: AI 服务器及上游核心芯片需求维持稳定,看好 2024 年市场增长	. 35
	6.7. 通信: 通信相关需求低迷,预计今年市场需求进一步下滑	
	本周海外半导体行情回顾	
	本周(02/26-03/01)半导体行情回顾	
	本周(02/26-03/01)重点公司公告	
10). 本周(02/26-03/01)半导体重点新闻	.41



1. 本周观点(02/26-03/01): 三星智能戒指亮相 MWC,华为P70产业链主题机会值得把握

行业周期当前处于相对底部区间,我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度,优先复苏的品种财务报表有望优先改善,长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位,经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面,人工智能/卫星通讯/MR 将是较大的产业趋势,产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。

三星智能戒指 Galaxy Ring 首次在 MWC 2024 展示,AI 或重燃可穿戴商机,看好大厂入局后智能戒指渗透率提升。三星在 MWC 2024 首次展示 Galaxy Ring,产品内圈具有多个传感器,可以监测心率、血氧饱和度、步数等健康数据,产品预计年内面世。作为新一代智能穿戴设备,智能戒指的产品形态、重量比普通戒指的平均重量更轻,舒适度优于现有腕上智能设备。由于手指处的皮肤透光性更好、设备佩戴更贴合,且血液、血流信息更加丰富,智能戒指具备较高的生物信息采集效率,是健康监测的较佳选择。除健康监测功能外,苹果、三星的有关专利表明其有望成为空间交互传感器和现有智能设备协同。智能戒指市场目前仍处于萌芽期,我们认为三星的入局有望加速市场教育,加速产品渗透率提升。

华为 P70 预计发售在即,产业链或迎来双击,建议关注。华为 P70 系列预计发售在即(P60 于 23 年 3 月末发布),据媒体报道,新机在影像/卫星通讯/外观等领域有升级,值得期待。2023 年 Mate60 系列发售以来,华为手机销量持续亮眼,Counter Point 数据显示,2024 年前两周,华为手机在中国市场的销量份额重回第一,华为手机产业链预计随着华为手机出货量提升,将有望体现出营收业绩双增,我们认为考虑到华为品牌"王者归来",在手机品牌中结构性增长,相关产业链有望迎来双击行情。

供给侧,半导体先进封装材料需求旺盛,AI 拉动叠加国产替代,2024 年有望较快速增长。2023 年,半导体材料市场整体呈现出了下滑的态势,主要是由于半导体行业增长整体放缓以及晶圆厂产能利用率下降。进入2024 年,受到新产能建设节奏影响(例如和远气体,新产能于24年2月27日公告取得试产通知书),预计板块迎来增长之年。其中半导体先进封装受到下游AI需求拉动,国内先进封装产能(如长电先进/盛合京微等)扩产速度预计快于传统封装,先进封装材料考虑到国产替代的趋势,预计2024年有望较快速增长。



图 1: 海外半导体公司业绩跟踪

海外市场半导体公司业绩跟踪 || 2024

公司名称 Manage Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand Hand	2024/2/1 2024/2/5 2024/1/30 2024/2/23	本期 2024/4/29 2024/5/1	货币	上季		本季預期	下季	上季	本季预期	下季	上季		本季预期	下季	上季	本季預期	下季	变化
日月光ASE 安徽Amkor 力成成科技 京元电子 製工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	2024/2/5 2024/1/30		TWD	0.0000000000000000000000000000000000000														
安 無 Amkor 力 京 元 東 政 本 年 東 本 近 知 际 東 本 近 知 际 本 近 知 時 中 本 近 和 市 中 本 近 和 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	2024/2/5 2024/1/30		low T k								A. V.							
力成科技 京元 制 中 地 野 田 半 号 体 台 联 电 七 知 电 电 形 电 地 司 电 电 形 电 也 的 电 电 形 电 也 的 电 电 形 电 电 方 电 电 方 电 电 方 电 电 方 传 电 专 后 电 色 后 色 色 色 色 色 三 色 色 三 色 二 色 三 色 三 色 三 一 色 三 一 二 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	2024/1/30	2024/5/1		160, 581	in line	132, 527	143, 906	. 5%	. 3%	5 6%	9, 392	beat	6, 144	8, 602	5.8%	4.6%	6.0%	_
京元电子 制造 中芯国际 华虹半导体 台联电 联电 形罗方德 三星		2024/4/25		1, 752 19, 034	beat	1, 365 17, 526	1,408 19,051	■ 1% 3 4%	1 3%	1 6%	118 3, 965	beat	29 1, 320	43 1, 663	6. 7% 20. 8%	2. 1% 7. 5%	3.0% 8.7%	_
制造 中芯国际 华虹半导体 台积电 联电 格罗方德 三星		2024/5/6		8, 500	miss	8, 170	9, 016	-4.0%	2%	10.4%	1,578	beat	1, 326	1, 671	18. 6%	16.3%	18.5%	-
华虹半导体 台积电 联电 格罗方德 三星						10000400000	20102202		-	000 00000					10000000	10040000000		
台积电 联电 格罗方德 三星	2024/2/6	2024/5/13	USD	1, 678	beat	1, 691	1,708	3.5%	15.6%	9.4%	174	beat	86	116	10.4%	5.1%	6.8%	_
联电 格罗方德 三星		2024/5/13		455	miss	476	509	-28.5%	-24.5%	19.4%	35	beat	-13	5	7. 8%	-2.7%	1.0%	_
格罗方德 三星		2024/4/22		625, 529	beat	577, 939	615, 828	0.0%	13.6%	28. 1%	238, 712	beat	212, 346	228, 072	38. 2%	36. 7%	37.0%	_
三星		2024/4/24 2024/5/9		54, 958 1, 854	in line in line	53, 448 1, 521	55, 991 1, 576	-19.0%	-1. 4% -17. 4%	-0.5% -14.6%	13, 195 306	miss	10, 630 129	11, 652 143	24. 0% 16. 5%	19. 9% 8. 5%	20.8% 9.0%	_
		2024/3/9		67,779,938	in line	70, 871, 342	70, 184, 281	-3.8%	11.2%	17.0%	5, 290, 751	miss	4,582,871	5, 690, 188	7. 8%	6.5%	8.1%	-
Towerjazz		2024/5/15		352	miss	325	337	-12 8%	-8.75	-5. 📆	-194	beat	45	48	-55. 1%	13.9%	14. 2%	
东部高科		2024/5/13		283, 045	in line	257, 000	235,000	-28.7%	-13.8%	-23.9%	35, 643	miss	41,000	26, 500	12.6%	-	16.0%	-
世界	2024/2/2	2024/5/3	TWD	9, 674	miss	9, 219	9, 842	1, 1%	12.6%	-0.1%	2, 388	miss	1,001	1, 269	24. 7%	10.9%	12.9%	_
CPU/GPU																		
英特尔 英伟达		2024/4/26		15, 406 22, 103	in line	12, 797 24, 018	13, 644 25, 891	9. 7% 265. 3%	9. 25 234. 0%	91. 7%	1, 734 12, 210	in line miss	563 13, 486	1, 045 14, 277	11. 3% 55. 2%	4. 4% 56. 1%	7. 7% 55. 1%	_
央市心 AMD		2024/5/24		6, 168		5, 444	5, 700	10. 2%		6.4%	697	heat	982	1, 114	11.3%	18.0%	19.5%	
存储	2021/1700	2021/0/2	000	0, 100	-	0, 111	0,700				0,,		702		111.0%	10.0%	17.00	
美光	2023/12/2	2024/3/20	USD	4, 726	in line	5, 321	5, 921	15.7%	44.1%	57.8%	-1, 184	in line	-324	176	-25. 1%	-6.1%	3.0%	_
西部数据	2024/1/25	2024/5/8	USD	3,032	beat	3, 304	3,602	-2.4%	17.9%	34.8%	-258	miss	21	230	-8.5%	0.6%	6.4%	_
旺宏		2024/4/25		7, 283	beat	6, 528	6, 062	36.5%	-28.1%	-14.7%	-408	beat	-656	-783	-5. 6%	-10.0%	-12.9%	_
希捷		2024/4/19		1,555	miss	1,666	1,827	17.6%	10.4%	14. 1%	-4	miss	55	124	-0. 2%	3.3%	6.8%	
南亚科技 东芝		2024/4/11 #N/A N/A	JPY	8, 704 793, 545	in line in line	9, 872	11,519	9.4%	53. 7%	63. 9%	-2, 405 -24, 801	miss	-1, 436	-212	-27. 6% -3. 1%	-14.5%	-1.8%	
东之 SK Hynix		#N/A N/A 2024/4/26		11, 305, 505	in line	11, 548, 184	13, 429, 977	47.4%	127.05	83.8%	-24, 801 -1, 357, 105	beat	559,075	1, 543, 896	-3. 1% -12. 0%	4.8%	11.5%	_
数据中心		/ -// 20									., .,,,,,,,,				. 2. 0.4	7. 0/1		
賽灵思	2022/1/26	#N/A N/A	USD	1,011	in line	1, 026	1, 046	25.8%	20.6%	19.0%	314	in line	293	293	31.1%	28.6%	28.0%	_
Lattice	2024/2/12	2024/5/1	USD	171	beat	140	141	-8.0%	-2 3. 9%	-2 6. 0%	45	beat	39	38	26. 4%	28. 1%	27.3%	_
迈威尔科技			USD	1,419	miss	1, 419	1,366	-78 7%	0.1%	3.4%	-70	miss	405	359	-4.9%	28.5%	26.3%	_
博通			USD	9, 295	beat	11, 584	11,962	4.1%	29.9%	37.0%	3, 613	miss	5, 042	5, 418	38. 9%	43.5%	45.3%	_
Credo	2023/11/2	2024/2/27	USD	44	beat	52	60	□ -14. 3%	-3.7%	85.9%	-7	beat	4	8	-15.0%	7.1%	12.6%	
手机芯片 高通公司	2024/1/21	2024/5/3	lien	9, 935	in line	9, 327	9, 055	5.0%	0.6%	7, 1%	2, 621	in line	2, 604	2.409	26. 4%	27. 9%	26. 6%	
同週公司 联发科		2024/5/3		129, 562	in line	123, 603	127, 794	19.7%	29. 2%	30.2%	25, 663	in line	22, 027	22, 549	19.8%	17. 8%	17.6%	_
思佳讯解决方案		2024/5/8		1, 202	beat	1, 046	1,024	9.6%	-9.3%	E -4.4%	245	beat	245	236	20. 4%	23. 4%	23. 1%	_
QORVO		2024/5/3		1,074	in line	926	919	44.5%	46. 4%	41.2%	89	in line	118	123	8. 3%	12.7%	13.4%	_
KNOWLES		2024/4/26		215	beat	195	205	9.2%	35.3%	18. 2%	38	miss	17	21	17. 9%	8.6%	10.4%	_
神盾		2024/3/29		947	beat	-	-	19.0%	-	-	-224	beat	15		-23. 7%	-	-	_
FPC	2024/2/8	2024/5/7	SEK	200	in line	-	-	5.3%	-	-	-127	miss	-9	-	-63.5%	-	-	
機模	2024/4/20	2024/4/25	1100	4, 077	In Item	3, 610	3, 774	-12.7%	-17 6%	-16 7%	1 242	4-4	995	1, 088	33.4%	27. 6%	28.8%	
徳州仪器 ADI		2024/4/25		2,513	in line	2, 103	2, 195	-22 7%	-35 5%	-16 7%	1, 362 864	7880	632	1,088	34.4%	30.0%	31.4%	_
恩智浦	2024/2/5	2024/4/29		3, 422	-	3, 127	3, 122	3.3	0. 2%	-5.4%	917	-	822	793	26. 8%	26. 3%	25. 4%	_
意法半导体		2024/4/26		4, 282	in line	3, 609	3, 790	-3.2%	-15.0%	-12.4%	1,076	in line	534	599	25. 1%	14.8%	15.8%	_
微芯科技			USD	1,766	miss	1, 330	1,340	-18 6%	-40.5%	-41 4%	421	in line	311	317	23. 9%	23. 4%	23.6%	-
MPWR	2024/2/7	2024/5/3	USD	454	in line	447	476	-1.3%	-0.8%	7.9%	97	in line	130	141	21.3%	29.1%	29.6%	_
分立器件					V V					-12 7%								
安森美 Navitas		2024/5/1 2024/2/29		2, 018	in line	1, 850	1,828	-4. 1%	-5.6%	-12 /3	581	Deat	451 -14	433 -14	28. 8% 34. 3%	24. 4%	23.7%	_
英飞凌		2024/5/7		3, 702	in line	3, 610	3, 998	-6.3%	-12.4%	-2. 25	598	miss	501	670	16. 2%	13.9%	16.7%	-
赛普拉斯				560	in line	538	575	7.4%	10.2%	7.9%	42	in line	95	117	7. 6%	17. 7%	20.3%	_
设备																		
应用材料		2024/5/16		6, 707	beat	6, 521	6, 593	□ -0.5%	-1.6%	2.6%	1, 797	beat	1, 659	1, 647	26.8%	25.4%	25.0%	_
拉姆研究		2024/4/19		3, 758	miss	3, 717	3, 793	-28, 8%	-8.9%	18 2%	991	miss	966	972	26. 4%	26.0%	25.6%	_
科天半导体 阿斯麦		2024/4/26		2, 487 7, 237	in line	2, 303 5, 450	2, 450 6, 330	12.5%	-5% 1 -19. 2%	4. (5)	839 2, 337	miss in line	715 1, 128	781 1,530	33. 7% 32. 3%	31.0% 20.7%	31. 9% 24. 2%	_
泰瑞达		2024/4/1/		671	beat	5, 450	637	-8.4%	-8.2%	-6.9%	116	beat	1, 128	98	17. 3%	9.3%	15.4%	_
ASM Pacific		2024/2/27		3, 474	beat	3, 311	3, 497	-23.8%	-23.5%	-10.7%	47	beat	172	225	1.4%	5. 2%	6. 4%	_
盛美半导体		2024/2/28		169	beat	149	120	26.1%	37.6%	62.1%	26	beat	8	8	15.5%	5.5%	6.8%	_
EDA									,	1								
CADENCE		2024/4/24		1,069	beat	1,001	1, 104	18.8%	-2.1%	13.1%	298	beat	309	365	27. 9%	30.9%	33.1%	_
Synopsys	2024/2/21	2024/5/17	USD	1, 649	in line	1, 575	1, 648	21.1%	12.9%	10.8%	435	in line	485	512	26. 4%	30.8%	31.1%	
	2024 /4 /5	2024 / / / -	I I	(07.504	at a	400 000	452 225	£ 47.00	1	1 0 00	444 70-		144 105	120 000	10.00	24.0	40.70	
日本信越 SUMCO		2024/4/26		627, 501 105, 090	miss in line	600, 082 97, 333	652, 800 103, 400	-16.8% -10.5%	-7.0% -11.5%	8. 9% -6. 6%	114, 725 5, 195	in line	144, 190 6, 134	128, 900 7, 400	18. 3% 4. 9%	24. 0% 6. 3%	19. 7% 7. 2%	_
Siltronic		2024/3/12		349	in line	357	360	-26.4%	-24.4%	-11.1%	34	miss	25	-1	9. 7%	6. 9%	-0.3%	_
Global Wafer		2024/3/6		17, 376	in line	16, 910	16, 791	-3.7%	-8.0%	-9.8%	4, 410	miss	3, 817	3, 795	25. 4%	22.6%	22. 6%	_
手机厂商										100								
苹果		2024/5/2		119, 575	in line	91, 707	84, 511	2.1%	-3.3%	3.3%	33, 916	miss	23, 632	20, 479	28. 4%	25. 8%	24. 2%	_
小米集团		2024/3/25		70, 894	beat	72, 448	67, 388	0.6%	9.7%	13.3%	5, 142	beat	3, 830	3, 791	7. 3%	5. 3%	5.6%	_
服务器厂商													1000		1,000			
亚马逊		2024/4/26		169, 961	in line	142, 574	150, 202	13.9%	11.9%	11.8%	10, 974	best	11, 254	13, 509	6.5%	7.9%	9.0%	_
谷歌		2024/4/25		86, 310	in line	65, 776	71, 013	13.5%	-5. 7%	-4. 8%	21,503	in line	20, 857	23, 231	24.9%	31.7%	32.7%	
微软 Meta		2024/4/25		62, 020 40, 111	in line	60, 856 36, 059	64, 662 38, 168	17.6%	15. 1% 25. 9%	15.1% 19.3%	22, 154 15, 791	beat	20, 958 11, 845	21, 577 13, 132	35. 7% 39. 4%	34. 4% 32. 9%	33. 4% 34. 4%	_
腾讯		2024/4/20		154, 625	in line	157, 471	161, 805	10.4%	8.6%	7.9%	35, 628	in line	41, 499	43, 735	23.0%	26. 4%	27. 0%	_
阿里巴巴		2024/5/17		260, 348	beat	220, 693	245, 797	5.1%	6.0%	5.0%	38, 739	miss	28, 996	41, 309	14. 9%	13.1%	16.8%	-
纬颖		2024/5/8		58, 550	in line	64, 145	79, 187	-33.0%	-13.6%	40.6%	3, 515	in line	3, 514	4, 170	6. 0%	5.5%	5. 3%	-
广达	2023/11/1	2024/3/15	TWD	286, 505	beat	300, 424	276, 694	-25.0%	-7.9%	3.9%	12, 843	miss	9, 879	8, 791	4. 5%	3. 3%	3. 2%	_
汽车厂商																		
特斯拉	2024/1/24	2024/4/19	USD	25, 167	beat	25, 211	26, 908	3.5%	8. 1%	7.9%	2,001	beat	2, 380	2, 629	8.0%	9.4%	9.8%	_
小鹏		2024/3/18		8,530	beat	13, 310	13, 094	25.0%	158 9%	224.6%	-3, 109	beat	-3, 006	-2, 031	-36. 4%	-22.6%	-15.5%	_
蔚来		2024/3/5 2024/5/8		19, 067	in line	16, 776	15, 980	46. 6% -39. 0%	4.4%	49. 7% 19. 0%	-4, 763 -659	miss	-4, 140 -605	-3, 086 -623	-25.0% -419.0%	-24. 7% -365. 0%	-19.3% -247.2%	_
Lucid 理想		2024/5/8		157 34, 679	in line miss	165 39, 797	180 36, 372	271. 2%	10. 7% 125. 5%	93.6%	-659 2, 823	miss	-605 3, 452	-623 3, 111	-419. 0% 8. 1%	-365. 9% 8. 7%	-347. 2% 8. 6%	_

资料来源: Bloomberg, 天风证券研究所

注:若无特别注明,单位均为百万,本期预期及下期预期均取自 Bloomberg 一致预期;

[&]quot;beat"表示上季度实际数据高于彭博一致预期超过 1%,"miss"表示低于彭博一致预期超过 1%,"in line"表示实际披露数据与彭博一致预期相差小于 1%



2. 本周(02/26-03/01) 重要事件及行情更新

行业头条:

- 1、英美等 10 国建立 6G 无线通信联盟;
- 2、电动自行车用锂电池充电强制性国家标准,或今年出台(央视);
- 3、2024 年全球 DRAM 芯片销售额将增长 46% (TechInsights);
- 4、2023年我国光伏行业总产值超 1.7万亿元,量增价减(工信部);
- 5、预计 2024 年全球服务器整机出货 1365,4 万台 (TrendForce);
- 6、美国商务部以安全为由调查中国组装智慧联网汽车(美国商务部);
- *资料来源:芯八哥公众号

厂商动态:

- 1、阿里云全线降价 20%, 最高降幅达 55% (财联社);
- 2、库克宣布苹果公司正在向生成式人工智能大力投资;
- 3、英特尔已获得价值 150 亿美元的芯片代工订单;
- 4、日本瑞萨电子终止收购半导体企业 Seguans;
- 5、欧姆龙将在全球裁员 2000 人 约为员工总数的 7%;
- 6、KKR 宣布将以约 40 亿美元收购博通终端用户计算部门:
- 7、华为发布全球首个 5.5G 智能核心网解决方案;
- 8、苹果公司决定放弃电动汽车项目(CNBC);
- 9、中微公司 2023 年净利润约 17.86 亿元, 同比增加 52.67%;
- 10、微软推出面向金融的 Copilot 聊天机器人,由 OpenAl 驱动;
- 11、台积电台中二期扩厂计划通过,将建四座 2nm 以下晶圆厂;
- 12、铠侠将扩大闪存产量,结束2022年以来的减产;
- 13、英飞凌宣布重组销售与营销组织,3月1日生效;
- 14、艾迈斯欧司朗宣布取消 Micro LED 项目;
- 15、德州仪器裁撤位于北京和深圳的芯片设计团队;
- 16、三星开发业界首款 36GBHBM3E 存储芯片, 12 层堆叠;
- 17、福建晋华赢得美国司法部诉讼;
- 18、博通暂停 10 亿美元 Carbon Black 安全软件业务销售;
- 19、欧洲最大光伏组件生产商 MBT 将关闭德国厂:
- 20、美光宣布开始批量生产 HBM3e;
- 21、小米汽车最快第二季度开始交付;
- 22、亚马逊 AWS 将投资超过 50 亿美元在墨西哥建数据中心集群;
- 23、SK hynix 披露 2024 年 HBM 供应已售罄;
- *资料来源:芯八哥公众号



供给端: TI 裁员,存储市场好转。

表 1: 供给端主要厂商动态

产业链	厂商	行情动态	影响/解读		
制造与封测	制造与封测 英特尔 已获得价值 150 亿美元的芯片代工订单				
	铠侠	将扩大闪存产量,结束 2022 年以来的减产	半导体市场好转		
	英飞凌	宣布重组销售与营销组织,3月1日生效	市场压力加大		
供应商	德州仪器	撤销位于北京和深圳的芯片设计团队	国内市场激烈竞争		
沃应問	福建晋华	赢得美国司法部诉讼	提振国内芯片厂商		
	美光	宣布开始批量生产 HBM3e	出现多供应商		
	SK hynix	2024 年 HBM 供应已售罄,预计 2025 年业绩将大涨	HBM 需求大幅增加		

资料来源:芯八哥公众号,华强云平台烽火台,天风证券研究所

需求端: 苹果放弃造车, 欧姆龙裁员。

表 2: 需求端主要厂商动态

类别	细分	行情动态	影响/解读		
消费电子	智能手机	预估 2024 年手机相机镜头市场回温,同比增 3.8%(TrendForce)	AI 智能手机驱动		
消费电丁	笔记本电脑	预计 2024 年一季度全球笔记本电脑出货季减 5.4% (DIGITIMES)	品牌缺乏出货动能		
a a	·····································	苹果取消了长达十年、投入数十亿美元的电动汽车计划	加大 AI 投资		
	7	小米汽车最快第二季度开始交付	小米布局成型		
服	务器	2024 年全球服务器整机出货量年增 2.05% (TrendForce)	美系 CSP 是主要动力		
Ħ	包视	2023 年全球电视出货量下滑约 3%,达 2.23 亿台(Counterpoint)	中国和欧洲市场下滑		
<u> </u>	光伏	2023 年我国光伏产业总产值超 1.7 万亿元,量增价减(工信部)	光伏价格战持续		
7	υχ	欧洲最大光伏组件生产商 MBT 将关闭德国厂	价格竞争加剧		
工业	自动化	日本欧姆龙将在全球裁员 2000 人	中国制造商崛起		
通信		通信 华为发布全球首个 5.5G 智能核心网解决方案,计划 2024 年商用			

资料来源: 芯八哥公众号, 华强云平台烽火台, 天风证券研究所

热门品牌分析: MCU 行情回暖, 存储芯片行情好转。

表 3: 本周热门品牌及料号分析

品牌	料号	品类	应用领域	热度	库存	价格	影响
ST/意法	STM32F103C8T6	微控制器	工业控制、智能家居等	高	下降	10.62%	需求改善,价格回升
31/忌/云	STM32F407VET6	微控制器	工业控制、智能家居等	高	稳定	62.69%	需求改善,价格回升
WINBOND/华邦	W25Q64JVSSIQ	存储芯片	各类电子产品	高	稳定	76.67%	需求改善,价格回升
MICROCHIP/微 芯	DSPIC30F2010-30I/SP	微控制器	通信、汽车、工业等	高	上升	-34.54%	需求下降,价格回落

资料来源:: 芯八哥公众号, 华强云平台烽火台, 天风证券研究所

芯片现货行情数据:

表 4: 芯片现货行情

型号热度榜	型号飙升榜	型号库存波动榜	
型号	型号	型믁	库存波动
BR24	BR24	BR24 IN4148W-TP	
LBZX	STM32F103C8T6	TCC0402X7R104K160AT	↑ 17982000
STM32F103C8T6	LM358	BAV99-TP	13200460
LM358	DLW5BTM501SQ2L	S8050	↓ 13066511
DLW5BTM501SQ2L	MAX13487EESA	SS8050	↓ 12131522



资料来源: 芯八哥公众号, 华强云平台烽火台, 天风证券研究所

3. 半导体产业宏观数据: 半导体销售恢复中高速增长, 存储成关键

行业内多家主流机构都比较看好 2024 年的半导体行情。其中,WSTS 表示因生成式 AI 普及、带动相关半导体产品需求急增,且存储需求预估将呈现大幅复苏,因此 2024 年全球半导体销售额将增长 13.1%,金额达到 5,883.64 亿美元,再次创历史新高;IDC 的看法比WSTS 乐观,其认为 2024 年全球半导体销售额将达到 6328 亿美元,同比增长 20.20%;此外,Gartner 也认为 2024 年全球半导体销售额将迎来增长行情,增长幅度将达到 16.80%,金额将达到 6328 亿美元。

表 5: 主流机构对半导体 2024 年的看法

机构名称	2023 年金额(亿 美元)	比例		比例
Gartner	5322	-11%	6240	16.80%
WSTS	5201.26	-9.40%	5880	13.10%
IDC	5265	-12%	6328	20.20%

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

从全球半导体销售额看,2023 年半导体行业筑底已基本完成,从Q3厂商连续数月的稳定增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上修2024 年全球半导体销售额预测,2024 年芯片行业将出现10%-18.5%之间的两位数百分比增长。其中,IDC和Gartner最为乐观,分别预测增长达20.2%和18.5%。

2024年全球半导体销售额增长预测 -20.0% 10.0% -13.0% -11.0% 18.5% -15.0% --10.3% 13.1% 13.1% -25.0% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% ■2023年 ■2024年

图 2: 各机构 2024 年全球半导体销售额增长猜测

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

从细分品类看, WSTS 预计 2024 年增速最快的前三名是存储、逻辑和处理器,分别增长 44.8%、9.6%和 7.0%。其他品类中,光电子增速最低,约 1.7%;模拟芯片受库存去化及需求 低迷影响,增速约 3.7%。总的来看,存储产品或将成为 2024 年全球半导体市场复苏关键,销售额有望恢复 2022 年水平。

半导体产业宏观数据:美国半导体工业协会(SIA)数据预测,2023 年全球半导体销售额约 5200 亿美元,同比下降 9.4%。值得关注的是,截至 2023 年 12 月全球半导体销售额已连续第十个月实现环比增长,芯片需求呈现出明显的回升势头,预计全球半导体市场在2024 年将强劲反弹。

天风证券

图 3: 全球半导体销售额



资料来源: SIA, 芯八哥公众号, 天风证券研究所

图 4: 中国集成电路产量



资料来源:工信部、SIA、芯八哥公众号,天风证券研究所

半导体指数走势: 2024年1月,中国半导体(SW)行业指数下降 22.98%,费城半导体指数(SOX)上升 5.91%。

图 5: 中国半导体(SW)行业指数



资料来源: Wind, 天风证券研究所

图 6: 费城半导体指数(SOX)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

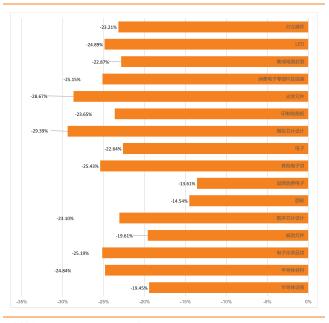
半导体细分板块: 2024 年 1 月,申万指数各电子细分板块大幅下跌。涨幅居前三名分别为品牌消费电子(-13.61%)、面板(-14.54%)和半导体设备(19.45%)。跌幅居前三名分别为模拟芯片设计(-29.39%)、光学元件(-28.67%)和其他电子(-25.43%)。

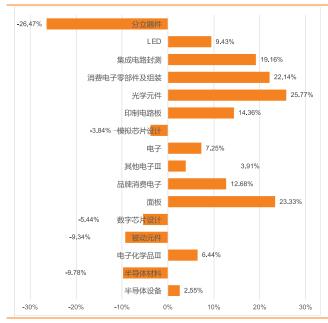
2023 年全年, 申万指数各电子细分板块大多上涨。涨幅居前三名分别为光学元件(25.77%)、面板(23.33%)和消费电子零部件及组装(22.14%)。有所下跌的板块为分立器件(-26.47%)、半导体材料(-9.78%)、被动元件(-9.34%)、数字芯片设计(-5.44%)和模拟芯片设计(-3.84%)等。

图 7: 电子(申万)各版块涨跌幅(24年1月)

图 8: 电子(申万)各版块涨跌幅(2023全年)







资料来源: Wind, 天风证券研究所

资料来源: Wind, 天风证券研究所

4. 芯片交期及库存:全球芯片交期持续改善,需求复苏下行业重回上升周期

整体芯片交期趋势: 1月,全球芯片交期持续改善,但行业库存仍有调整,部分细分品类 交期波动明显。



图 9: 全球芯片平均交货周期(周)

资料来源:芯八哥公众号,Susquehanna Financial Group,天风证券研究所

重点芯片供应商交期:从1月各供应商看,PMIC等模拟芯片、部分MCU等价格持续倒挂,MOSFET、IGBT等功率器件交期持续改善,地震影响下村田部分电容交期和价格波动明显,存储价格持续回升。

表 6: 头部厂商 1 月交期及趋势

类别	供应商	产品	1月交期/ 周	2 月交期/ 周	交期 趋势	价格趋势
模拟	AMS OSRAM	传感器	8-24	8-24	稳定	根据市场调整
悮拟	BOSCH	传感器	6-12	6-12	稳定	稳定



	Diodes	多源模拟/电源 ————————————————————————————————————	20-32	20-32 20-45	稳定稳定	稳定 稳定
		八人心丛田				*====
	ETDI Chin	接口	14-24	14-24	缩短	 稳定
	FTDI Chip		18-52	18-52	稳定	 上升
	Infineon		20-52	20-52	稳定	<u> </u>
	IIIIIIeon					
		汽车模拟和电源	45-52	45-52	稳定	稳定
	A D1 (A 4 - ')	放大器和数据转换器	15-30	15-30	缩短	上升
	ADI (Maxim)	接口	18-30	18-30	缩短	上升
		开关稳压器	20-30	20-30	缩短	稳定
		放大器和数据转换器	4-10	4-10	缩短	稳定
	Microchip	定时	7-12	7-12	缩短	稳定
		开关稳压器	4-25	4-25	缩短	上升
	MPS	开关稳压器	20-42	20-42	缩短	稳定
		传感器	16-52	16-52	稳定	稳定
	NXP	接口	20-30	20-30	缩短	稳定
		汽车模拟和电源	24-35	24-35	缩短	稳定
		传感器	18-52	18-52	稳定	根据市场调整
		放大器和数据转换器	18-26	18-26	缩短	稳定
	On Semi	定时	20-42	20-42	稳定	稳定
		多源模拟/电源	20-40	20-40	稳定	稳定
		开关稳压器	20-40	20-40	稳定	上升
	Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	稳定
		放大器和数据转换器	24-36	24-36	缩短	稳定
	Renesas	定时	50	50	稳定	稳定
	Nellesas	接口	24-36	24-36	缩短	稳定
		开关稳压器	20-40	20-40	稳定	稳定
	ROHM	传感器	24-52	24-52	延长	上升
	KOHIVI	开关稳压器	20-40	20-40	稳定	稳定
		传感器	12-18	12-18	缩短	稳定
		放大器和数据转换器	14-24	14-24	缩短	稳定
	ST	多源模拟/电源	20-42	20-42	缩短	稳定
		开关稳压器	20-40	20-40	缩短	稳定
		汽车模拟和电源	40-52	40-52	稳定	稳定
	TE	传感器	16-52	16-52	稳定	根据市场调整
	Vishay	传感器	24-52	24-52	延长	稳定
	Infineon	蓝牙模块	26-36	26-36	稳定	稳定
		WiFi 模块	16-26	16-26	缩短	稳定
	Microchip	蓝牙模块	12-26	12-26	稳定	稳定
		收发器/接收器	18-20	18-20	稳定	上升
射频		WiFi 模块	26-50	26-50	稳定	稳定
和无	Murata		26-50	26-50	稳定	稳定
线		 WiFi 模块	20-40	20-40	稳定	稳定
	Laird	天线	12-16	12-16	延长	稳定
		蓝牙模块	10-12	10-12	稳定	稳定
	ST	收发器/接收器	12	12	稳定	稳定
	31	以火砧/1女火砧	14	14		



			12	12	稳定	稳定
	NXP	RFID	20	20	稳定	稳定
		 大功率 IC	12-16	12-16	稳定	稳定
	On Semi		16-30	16-30	稳定	稳定
		低压 MOSFET	8-16	8-16	缩短	根据市场调整
		TVS 二极管	8-14	8-14	缩短	稳定
			8-30	8-15	稳定	稳定
			14-20	8-12	缩短	稳定
		整流器	8-30	8-13	稳定	稳定
		开关二极管	12-20	8-12	稳定	稳定
	Diodes	小信号 MOSFET	12-30	8-12	缩短	稳定
		齐纳二极管	12-20	8-12	稳定	稳定
		双极晶体管	12-20	8-12	缩短	稳定
		数字晶体管/RETS	12-20	8-12	缩短	稳定
		通用晶体管	12-20	8-12	缩短	稳定
		逻辑器件	8-10	8-10	稳定	稳定
		低压 MOSFET	10-36	10-36	缩短	根据市场调整
		高压 MOSFET	12-40	12-40	缩短	稳定
		IGBT	14-52	14-52	稳定	稳定
	Infineon	宽带隙 MOSFET	26-52	26-52	稳定	稳定
		数字晶体管/RETS	6-50	6-50	稳定	稳定
		通用晶体管	6-50	6-50	稳定	稳定
分立		军用-航空晶体管	22-52	22-52	稳定	稳定
器件		低压 MOSFET	50-54	50-54	缩短	稳定
		高压 MOSFET	14-40	14-40	缩短	稳定
		IGBT	14-52	14-52	缩短	稳定
		ESD	21-32	21-32	缩短	稳定
	ST	宽带隙 MOSFET	42-52	42-52	稳定	稳定
		晶闸管/Triac	15-16	15-16	稳定	稳定
		TVS 二极管	25-30	25-30	稳定	根据市场调整
		整流器	14-16	14-16	稳定	稳定
		双极晶体管	40-52	40-52	稳定	稳定
		低压 MOSFET	4-20	4-20	缩短	根据市场调整
		ESD	6-18	6-18	稳定	稳定
		肖特基二极管	4-16	4-16	缩短	稳定
		开关二极管	4-16	4-16	缩短	稳定
	Wingtech(Nexperia)	小信号 MOSFET	8-16	8-16	缩短	稳定
		齐纳二极管	4-16	4-16	缩短	稳定
		双极晶体管	4-16	4-16	缩短	稳定
		数字晶体管/RETS	4-16	4-16	缩短	稳定
		通用晶体管	4-16	4-16	缩短	稳定
		逻辑器件	6-8	6-8	稳定	稳定
		8位MCU	12-18	12-18	缩短	稳定
MCU	Renesas	32 位 MCU	18	18	缩短	稳定
		汽车	45	45	稳定	稳定
		32 位 MPU	18-26	18-26	稳定	稳定



		8 位 MCU	35-52	10-24	缩短	稳定
		汽车	40-52	40-52	稳定	稳定
		32 位 MPU	16-20	16-20	缩短	稳定
	ST	STM32FO	10-12	10-12	缩短	稳定
		STM32F1	16-20	16-20	缩短	稳定
		STM32L	16-20	16-20	缩短	稳定
		32 位 MCU	20-28	10-20	缩短	稳定
•		8 位 MCU	10-14	10-14	缩短	稳定
	Infineon	32 位 MCU	10-52	10-52	缩短	稳定
		汽车	紧缺	紧缺	稳定	稳定
•		8 位 MCU	4-16	4-16	缩短	稳定
	Microchip	32 位 MCU	4-28	4-28	缩短	稳定
		32 位 MPU	4-24	4-24	稳定	稳定
•		8 位 MCU	13-39	13-39	缩短	稳定
	NXP	32 位 MCU	13-39	13-39	缩短	稳定
		汽车	18-52	18-52	稳定	稳定
		32 位 MPU	18-52	18-52	缩短	稳定
可编	AMD (Xilinx)		20-50	20-50	缩短	稳定
程逻	Intel (Altera)	FDCA	30-55	20-35	稳定	稳定
辑器	Lattice	FPGA	28-42	20-30	缩短	稳定
件	Microchip(Microsemi)		10-44	10-44	缩短	稳定
		DRAM(商用 PC)	52-54	52-54	稳定	稳定
	Company	存储器模块	52-54	52-54	稳定	稳定
存储	Samsung	eMMC	52-54	52-54	稳定	稳定
器		固态驱动器(SSD)	52-54	52-54	稳定	稳定
	CN Llumin	NAND flash	6-10	6-10	缩短	根据市场调整
	SK Hynix	eMMC	8-12	8-12	稳定	稳定
		滤波器	12-16	12-16	稳定	稳定
	N 4. 11-2 t-	电感/变压器	12-20	12-20	稳定	稳定
} d=4-	Murata	引线陶瓷电容	16-18	16-18	稳定	稳定
被动		专用电容	15-16	15-16	稳定	稳定
元件		滤波器	12-16	12-16	延长	稳定
	TDK	电感/变压器	16-20	16-20	稳定	稳定
		表面贴装通用陶瓷电容(车规级)	30-42	30-42	稳定	稳定

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

头部企业订单及库存情况:从企业订单需求看,整体市场需求复苏缓慢,厂商订单相对疲软,库存波动明显。

图 10: 头部厂商 1 月订单及库存

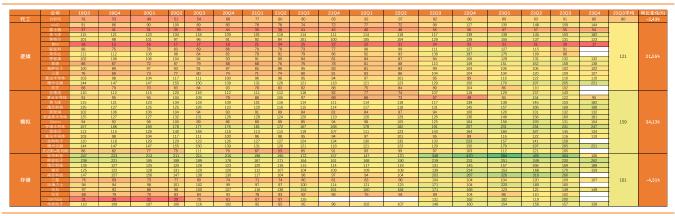


公司	1月订单	1月库存	2月订单趋势	2月库存趋势
Intel	稳定	一般	稳定	一般
AMD	稳定	一般	稳定	一般
NVIDIA	上升	无	上升	无
三星	稳定	一般	上升	一般
TI	稳定	较高	根据市场调整	较高
ST	稳定	低	根据市场调整	一般
ADI	稳定	低	上升	一般
Qualcomm	稳定	一般	根据市场调整	一般
Broadcom	稳定	一般	根据市场调整	低
NXP	稳定	低	根据市场调整	较低
Infineon	上升	低	根据市场调整	较低
Renesas	稳定	低	根据市场调整	一般
Onsemi	稳定	低	稳定	低
Microchip	稳定	一般	稳定	一般
Micron	稳定	一般	上升	一般
SK Hynix	稳定	一般	上升	一般
Murata	稳定	低	稳定	稳定
联发科	稳定	一般	根据市场调整	一般

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

2023 年第四季度,国际及中国台湾代工、存储板块公司存货周转天数同比下降,分别为-2.43%,-4.31%。逻辑、模拟板块公司存货周转天数同比上升,分别为+21.55%,+34.13%

图 11: 国际及中国台湾主要半导体厂商存货周转天数



资料来源: Capital IQ, Wind, 天风证券研究所

2023 年第三季度,中国大陆 IDM 板块公司存货周转天数同比小幅下降,其余各环节公司存货周转天数同比增加。封测、代工、装备、IDM、材料、设计各板块公司平均存货周转天数分别为 57 天、153 天、586 天、148 天、116 天和 253 天,同比分别为+10.66%,+25.34%,+23.49%,-5.34%,+31.32%和+9.72%。

图 12: 中国大陆主要半导体厂商存货周转天数



货用转天数																				
	公司	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4	22Q1	22Q2	22Q3	22Q4	23Q1	23Q2	23Q3	23Q3平均	同比变化(%
		67	70	72	68	69	60	66	64	65	50	81	82	81	81	93	76	80		
封测	通富微电	73	87	95	78	60	47	51	47	50	46	53	53	52	55	91	92	71	57	
		35	37	49	45	47	42	45	44	46	45	45	52	48	41	50	48	56	37	
	利揚芯片					15	12	15	16	20	26	28	19	25	29	38	28	21		
代工	中芯国际	91	91	85	85	73	82	90	91	100	102	103	106	117	123	157	163	165	153	25.34%
		75	71	85	91	91	95	121	150	134	134	116	121	128	139	152	144		100	20.044
	北方华创	512	387	582	482	381	321	577	496	426	314	685	598	489	475	570	554	479		
	拓荆科技											824	1022	714	680	1121	860	987		
	中微公司	581	202	369	279	335	224	293	291	341	271	340	367	458	334	492	472	469		
设备	华海清科												938	892	803	642	613	639	586	
	精測电子	184	207	403	326	382	178	240	180	318	234	255	337	318	339	460	443	562		
	盛美上海				_	001	400	55.4	4.00	004	461	775	420	418	548	948	562	664		
	正帆科技	000	0.45	nne	007	304	183	554	169	281	208	396	308	248	300	752	362 454	441		
	主統科技	321	245	886	237	489	191	587		549	227	316	338	261	209 185	340	157	449	-	-
		193	161 78	250	168	145 87	118	121 82	102	76	117	134 87	135 86	164 98	97	189 115	101	165	148	F 248
	华润撒电子 三安光电	89 211	158	96 250	236	244	76 154	185	136	156	90	187	160	206	173	218	148	171	148	-5.34%
	沪硅产业	211	98	116	113	137	95	111	106	111	97	100	95	100	97	136	146	154	+	-
材料	有研新材	20	21	34	32	31	23	28	31	28	31	30	44	36	27	43	55	48	116	31.32%
	雅克科技	96	104	109	100	78	116	81	89	103	83	116	105	129	122	146	127	146	110	31.32%
	纳芯微	- 50	104	103	100	10	110	- 01	- 00	132	168	141	122	161	1/9	224	395	342		
	东微半导				_					102	100	82	76	64	67	84	115	112		
	子邦股份	93	89	200	174	121	108	125	110	137	99	121	99	194	152	286	219	234	7	
设计	瑞芯微	125	102	177	111	76	64	68	53	83	98	154	156	466	276	609	394	409	253	9,72%
	品质股份	121	92	158	100	53	39	52	69	93	101	109	116	138	134	197	118	159	- 200	0
	中類电子	110	B7	98	77	62	59	61	58	73	88	80	105	175	229	309	263	291		
	4余股份	83	120	169	180	132	112	118	127	163	189	245	273	418	344	319	242	226	-	

资料来源: Wind, Capital IQ, 天风证券研究所

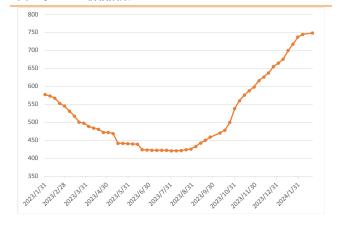
5. 产业链各环节景气度:

5.1. 设计: 库存去化效益显现,需求复苏有望带动基本面持续向好

5.1.1. 存储: 周期已触底反弹,本周 NAND Flash Wafer 和 DDR 资源价格上涨

根据闪存市场公众号对存储行情的周度(截至 2024.02.27)评述,本周上游资源方面,NAND Flash Wafer 和 DDR 资源价格上涨。渠道市场方面,近期渠道市场需求较淡,倒挂现象持续存在,现货贸易 wafer 氛围浓烈,减少了成品制造,资源成本上涨助推渠道 SSD 和内存价格。行业市场方面,继 1 月部分行业客户积极备货后,节后行业整体需求平淡,不过部分行业资源成本仍在上扬,SSD 成品端价格持平为主,市场倒挂压力加剧。本周行业 SSD 基本持平,内存价格小幅上涨。嵌入式市场方面,原厂资源控货涨价但成品端价格小幅下修,嵌入式 Flash 行情重新进入博弈阶段,LPDDR4X 供应趋紧,现货市场嵌入式价格本周持平。

图 13: NAND 价格指数



资料来源:闪存市场官网,天风证券研究所

图 14: DRAM 价格指数



资料来源:闪存市场官网,天风证券研究所

上游资源方面,本周 NAND Flash Wafer 和 DDR 资源价格上涨,1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC NAND Flash Wafer 价格为 6.40/6.90/3.55/1.85 美元,DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT 价格分别为 3.20 /2.80/1.55/1.30/0.75 美元。

图 15: Flash Wafer 最新报价(当前价为美元)

图 16: DDR 最新报价(当前价为美元)



当前价	前收盘	涨跌
6.40	6.20	3.23%
0.40	0.20	0.20
6.00	6.80	1.47%
0.90	0.80	0.10
3 55	2 55	0.00%
3.33	5.55	0.00
1 95	1.80	2.78%
1.03	1.00	0.05
	当前价 6.40 6.90 3.55 1.85	6.40 6.20 6.90 6.80 3.55 3.55

产品名称 上周价 本周价 涨跌 3.23% DDR4 16Gb 3200 3.20 3.10 0.10 7.69% DDR4 16Gb eTT 2.80 2.60 0.20 3.33% DDR4 8Gb 3200 1.55 1.50 0.05 4.00% DDR4 8Gb eTT 1.30 1.25 0.05 0.00% DDR4 4Gb eTT 0.75 0.75 0.00

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

渠道市场方面,近期渠道市场需求较淡,倒挂现象持续存在,现货贸易 wafer 氛围浓烈,减少了成品制造,**资源成本上涨助推渠道 SSD 和内存价格。行业市场方面,**继 1 月部分行业客户积极备货后,节后行业整体需求平淡,不过部分行业资源成本仍在上扬,SSD 成品端价格持平为主,市场倒挂压力加剧。本周行业 SSD 基本持平,内存价格小幅上涨。

图 17: 渠道市场 SSD 最新报价(当前价为美元)

产品名称 本周价 上周价 涨跌 SSD 120GB SATA 3 8.70 8.60 1.16% SSD 240GB SATA 3 14.80 14.40 2.78% O.40 2.40% 0.40 SSD 480GB SATA 3 25.00 24.40 2.46% O.60 0.60 2.56% 0.40 SSD 256GB PCIe 3.0 27.20 26.60 2.26% O.60 0.60 2.26% 0.60 SSD 1TB PCIe 3.0 50.00 48.70 1.30 SSD 512GB PCIe 4.0 37.40 36.20 3.31% 1.20 SSD 1TB PCIe 4.0 56.00 53.20 5.26% 2.80 SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00 5.00%	国 17: 朱旭中物 220 取机取训(3月11/3天儿)						
SSD 120GB SATA 3 8.70 8.60 0.10 SSD 240GB SATA 3 14.80 14.40 2.78% SSD 480GB SATA 3 25.00 24.40 2.46% SSD 256GB PCIe 3.0 16.00 15.60 2.56% SSD 512GB PCIe 3.0 27.20 26.60 0.60 SSD 1TB PCIe 3.0 50.00 48.70 2.67% SSD 512GB PCIe 4.0 37.40 36.20 3.31% SSD 1TB PCIe 4.0 56.00 53.20 5.26% SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00 5.00%	产品名称	本周价	上周价	涨跌			
SSD 240GB SATA 3 14.80 14.40 2.78% SSD 480GB SATA 3 25.00 24.40 2.46% SSD 256GB PCIe 3.0 16.00 15.60 2.56% SSD 512GB PCIe 3.0 27.20 26.60 0.60 SSD 1TB PCIe 3.0 50.00 48.70 2.67% SSD 512GB PCIe 4.0 37.40 36.20 3.31% SSD 1TB PCIe 4.0 56.00 53.20 5.26% SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00 5.00%	SSD 120GB SATA 3	8.70	8.60				
SSD 480GB SATA 3 25.00 24.40 2.46% 0.60 SSD 256GB PCIe 3.0 16.00 15.60 2.56% 0.40 SSD 512GB PCIe 3.0 27.20 26.60 0.60 SSD 1TB PCIe 3.0 50.00 48.70 2.67% 1.30 SSD 512GB PCIe 4.0 37.40 36.20 3.31% 1.20 SSD 1TB PCIe 4.0 56.00 53.20 5.26% 2.80 SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00 5.00%	SSD 240GB SATA 3	14.80	14.40	2.78%			
SSD 256GB PCIe 3.0 16.00 15.60 2.56% 0.40 SSD 512GB PCIe 3.0 27.20 26.60 2.26% 0.60 SSD 1TB PCIe 3.0 50.00 48.70 2.67% 1.30 SSD 512GB PCIe 4.0 37.40 36.20 3.31% 1.20 SSD 1TB PCIe 4.0 56.00 53.20 5.26% 2.80 SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00 5.00%	SSD 480GB SATA 3	25.00	24.40	2.46%			
SSD 512GB PCIe 3.0 27.20 26.60 2.26% SSD 1TB PCIe 3.0 50.00 48.70 2.67% SSD 512GB PCIe 4.0 37.40 36.20 3.31% SSD 1TB PCIe 4.0 56.00 53.20 5.26% SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00 5.00%	SSD 256GB PCIe 3.0	16.00	15.60	2.56%			
SSD 1TB PCIe 3.0 50.00 48.70 2.67% SSD 512GB PCIe 4.0 37.40 36.20 3.31% SSD 1TB PCIe 4.0 56.00 53.20 5.26% SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00 5.00%	SSD 512GB PCIe 3.0	27.20	26.60	2.26%			
SSD 512GB PCIe 4.0 37.40 36.20 3.31% 1.20 SSD 1TB PCIe 4.0 56.00 53.20 5.26% 2.80 SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00 5.00%	SSD 1TB PCIe 3.0	50.00	48.70				
SSD 1TB PCIe 4.0 56.00 53.20 1.20 5.26% 2.80 SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00 5.00%	CCD 512CD DCI- 4.0	27.40	26.20				
SSD 1TB PCIe 4.0 56.00 53.20 2.80 SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00 5.00%	55D 512GB PCIe 4.0	37.40	30.20				
SSD 2TB PCIe 4.0 105.00 100.00	SSD 1TB PCIe 4.0	56.00	53.20				
	SSD 2TB PCIe 4.0	105.00	100.00				

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

图 19: 渠道市场内存条最新报价(当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 UDIMM 8GB 3200	13.70	13.40	2.24%
DDR4 ODIWIWI 8GB 3200	13.70	13.40	0.30
DDR4 UDIMM 16GB 3200	24.00	24.00	0.00%
DDK4 CDIMINI 10GB 3200	24.00	24.00	0.00
DDR4 UDIMM 32GB 3200	49.00	48.40	1.24%
DDR4 CDIMINI 32GB 3200	49.00	40.40	0.60

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

图 18: 行业市场 SSD 最新报价(当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌			
SSD 256GB SATA 3	18.00	18.00	0.00%			
33D 230GB 3ATA 3	18.00	18.00	0.00			
SSD 512GB SATA 3	32.00	32.00	0.00%			
33D 312GB 3A1A 3	32.00	32.00	0.00			
SSD 1TB SATA 3	55.00	55.00	0.00%			
SSD TID SATA S	33.00	33.00	0.00			
SSD 256GB PCIe 3.0	20.50	20.50	0.00%			
33D 2300B I CIC 3.0	20.50	20.50	0.00			
SSD 512GB PCIe 3.0	35.50	35.50	0.00%			
33D 312GB 1 CIC 3.0	33.30	33.30	0.00			
SSD 1TB PCIe 3.0	61.00	61.00	0.00%			
33D 11B 1 Clc 3.0	01.00	01.00	0.00			
SSD 512GB PCIe 4.0	36.50	36.50	0.00%			
33D 312GB 1 CIC 4.0	30.30	30.30	0.00			
SSD 1TB PCIe 4.0	64.00	64.00	0.00%			
33D 11D 1 Cle 4.0	04.00	04.00	0.00			
SSD 2TB PCIe 4.0	116.00	110.00	5.45%			
55D 21D 1 CIC 4.0	110.00	110.00	6.00			

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

图 20: 行业市场内存条最新报价(当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 SODIMM 4GB 3200	11.00	10.00	10.00%
BBRT SOBININI TOB 3200	11.00	10.00	1.00
DDR4 SODIMM 8GB 3200	18.00	16.30	10.43%
2211. 2021. Mil 002 3200		10.50	1.70
DDR4 SODIMM 16GB 3200	30.00	27.50	9.09%
DDR : 50DE::IM 100B 3200	30.00	27.30	2.50

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

嵌入式市场方面,原厂资源控货涨价但成品端价格小幅下修,嵌入式 Flash 行情重新进入博弈阶段,LPDDR4X 供应趋紧,**现货市场嵌入式价格本周持平。**

图 21: eMMC 最新报价(当前价为美元)

图 22: LPDDR 最新报价(当前价为美元)



产品名称	本周价	上周价	涨跌
eMMC 8GB 5.1	2.00	2.00	0.00%
			0.00
eMMC 16GB 5.1	2.60	2.60	0.00%
			0.00%
eMMC 32GB 5.1	2.85	2.85	0.00
eMMC 64GB 5.1	4.50	4.50	0.00%
CIVILVIC 040B 3.1	4.50	4.50	0.00
eMMC 128GB 5.1	7.80	7.80	0.00%
			0.00
eMMC 256GB 5.1	16.50	16.50	0.00%
			0.00

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

图 23: UFS 最新报价(当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
UFS 64GB	5.00	5.00	0.00%
C15 04GB	3.00	3.00	0.00
UFS 128GB	8.50	8.50	0.00%
01'S 128GB	8.50	8.50	0.00
UFS 256GB	17.50	17.50	0.00%
01'S 230GB	17.50	17.50	0.00

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

产品名称	本周价	上周价	涨跌
LPDDR4X 96Gb	26.50	26.50	0.00%
LI DDR4X 7000	20.50	20.50	0.00
LPDDR4X 64Gb	19.50	19.50	0.00%
LI DDR4X 0400	17.50	17.50	0.00
LPDDR4X 48Gb	13.30	13.30	0.00%
LI DDR4X 4000	13.30	13.30	0.00
LPDDR4X 32Gb	8.20	8.20	0.00%
LI DDR4X 3200	0.20	0.20	0.00
LPDDR4X 16Gb	3.60	3.60	0.00%
LI DDR4X 1000	3.00	3.00	0.00
LPDDR4X 8Gb	2.30	2.30	0.00%
LI DDR4X 600	2.30	2.30	0.00

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

图 24: uMCP 最新报价(当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
uMCP(LPDDR4X+UFS2.2)	17.00	17.00	0.00%
4GB+128GB	17.00	17.00	0.00
uMCP(LPDDR4X+UFS2.2)	22.50	22.50	0.00%
6GB+128GB	22.30	22.30	0.00
uMCP(LPDDR4X+UFS2.2)	28.00	28.00	0.00%
8GB+128GB	28.00	28.00	0.00
uMCP(LPDDR4X+UFS2.2)	39.00	39.00	0.00%
8GB+256GB	39.00	39.00	0.00

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

图 25: eMCP 最新报价(当前价为美元)

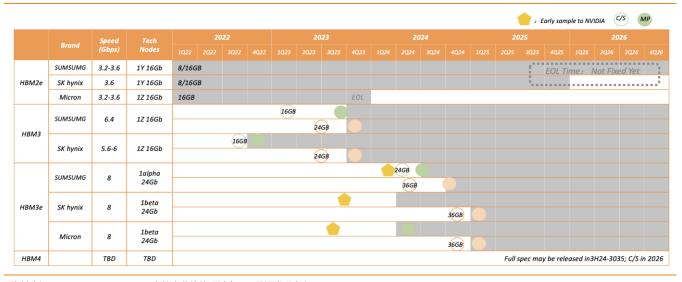
产品名称	本周价	上周价	涨跌
eMCP(eMMC+LPDDR4X)64GB+32Gb	13.20	13.20	0.00%
CIVICI (CIVILVIC LI DDR4X)040D 3200	13.20	13.20	0.00
eMCP(eMMC+LPDDR4X)128GB+32Gb	17.00	17.00	0.00%
CIVICI (CIVILVIC EI DDR4X)1200D 3200			0.00
eMCP(eMMC+LPDDR4X)128GB+48Gb	22.50	22.50	0.00%
Chief (Chimie Li DDR4A)1200D 4000	22.30	22.30	0.00

资料来源:闪存市场公众号,天风证券研究所

NVIDIA H200 发布催化 HBM 发展: 英伟达发布全新 H200 GPU 及更新后的 GH200 产品 线。相比 H100,H200 首次搭载 HBM3e,运行大模型的综合性能提升 60%-90%。而新一代的 GH200 依旧采用 CPU+GPU 架构,也将为下一代 AI 超级计算机提供动力。HBM3E 是市场上最先进的高带宽内存(HBM)产品,HBM 即为高带宽内存(High Bandwidth Memory),是一种基于 3D 堆栈工艺的高性能 DRAM,通过增加带宽,扩展内存容量,让更大的模型,更多的参数留在离核心计算更近的地方,从而减少内存和存储解决方案带来的延迟、降低功耗。HBM 的高带宽相当于把通道拓宽,让数据可以快速流通。因此面对 AI 大模型千亿、万亿级别的参数,服务器中负责计算的 GPU 几乎必须搭载 HBM。英伟达创始人黄仁勋也曾表示,计算性能扩展的最大弱点是内存带宽,而 HBM 的应用打破了内存带宽及功耗瓶颈。在处理 Meta 的大语言模型 Llama2(700 亿参数)时,H200 的推理速度比 H100 提高了 2 倍,处理高性能计算的应用程序上有 20%以上的提升,采用 HBM3e,完成了 1.4 倍内存带宽和 1.8 倍内存容量的升级。

HBM 的制程发展: 目前市场上最新 HBM3E,即第 5 代 HBM,正搭载在英伟达的产品中。随着 AI 相关需求的增加,第六代高带宽存储器 HBM4 最早将于 2026 年开始量产。据韩媒报道,SK 海力士已开始招聘 CPU 和 GPU 等逻辑半导体设计人员。SK 海力士希望 HBM4 堆栈直接放置在 GPU 上,从而将存储器和逻辑半导体集成在同一芯片上。这不仅会改变逻辑和存储设备通常互连的方式,还会改变它们的制造方式。如果 SK 海力士成功,这可能会在很大程度上改变部分半导体代工的运作方式。





资料来源: TrendForce, MTS2024 存储产业趋势研讨会, 天风证券研究所

HBM 迭代进程: 2024 年 HBM2、HBM2e 和 3e 的市场份额会发生比较明显的改变。 2023 上半年主流还是 HBM2e,但是因为 H100 的问世,下半年 HBM3 就成为市场主流,很快 2024 年就会进行到 HBM3e,因为它堆叠的层数更高,所以平均单价一定要比现在再高 20%-30%以上,所以它对产值的贡献会更明显。

图 27: HBM 比重转进(依位元计算)



资料来源: TrendForce, MTS2024 存储产业趋势研讨会, 天风证券研究所

2024 年存储下游需求预判:对于 PC、移动、汽车和工业领域大多数客户来说,存储库存已经处于或接近正常水平。数据中心客户的存储产品库存正在改善,美光预计客户库存将在 2024 年上半年的某个时候接近该市场的正常水平。另外,在数据中心和 PC 市场中,DRAM 产品正逐渐过渡到 DDR5,美光预计在 2024 年初 DDR5 的销量将超越 DDR4。生成式人工智能应用将从数据中心扩展到边缘,最近市场发布了几款具有 AI 功能的 PC 和智能手机,另外,汽车和工业终端市场也将嵌入 AI。边缘设备上的人工智能将进一步增强隐私、降低延迟、提高性能、提供更大的个性化等更多优点。

服务器市场: 2023 年数据中心服务器出货量出现两位数百分比下降后,CFM 闪存市场预计 2024 年服务器总出货量将出现中个位数百分比增长。另一方面,随着 AI 发展,服务器客户预算将从传统服务器转移到人工智能服务器。一些客户推出的新款 GPU 和 AI 加速产品路线图显示对高带宽内存(HBM) 容量、性能和功耗的要求不断增加。

PC 市场: CFM 闪存市场预计 PC 销量在连续两年出现两位数百分比下降之后,到 2024 年将出现低至中个位数百分比的增长。美光预计 PC OEM 厂商将在 2024 下半年开始增加搭载 AI 的 PC,每台额外增加 4 -8GB DRAM 容量,SSD 平均容量也会增加。

Mobile 市场:在移动领域,智能手机需求显示出复苏迹象,CFM 闪存市场预计 2024 年智



能手机出货量将小幅增长。美光预计智能手机 OEM 将在 2024 年开始大量生产支持人工智能的智能手机,每台额外增加 4-8GB DRAM 容量。

汽车和行业市场:工业和汽车市场边缘人工智能的扩散持续增加,对内存需求也将显著增加。CFM 闪存市场预计支持人工智能的工业 PC 的内存容量比标准 PC 将增长 3-5 倍,与标准非 AI 视频摄像机相比,支持 AI 的边缘视频安全摄像机的内存容量增加了 8 倍。

2024 年一季度存储价格预判: 24Q1 整体存储市场价格展望乐观,其中 Mobile DRAM 及 NAND Flash(eMMC/UFS)均价季涨幅将扩大至 18~23%。2024 年第一季存储器价格走势 在客户端需求持续,以及原厂仍未拉升稼动的情况下,供需缺口加大,Mobile 存储器涨幅 将较其他应用更明显,将成为该季领涨项目。

2024 年第一季度价格预判: 1) NAND: 为避免缺货,买方持续扩大 NAND Flash 产品采购以建立安全库存水位,而供应商为减少亏损,对于推高价格势在必行,预估 2024 年第一季 NAND Flash 合约价季涨幅约 15-20%,其中预期 CSSD 涨幅 15-20%,ESSD 涨幅 18-23%, eMMC UFS 涨幅 18-23%, 3D NAND wafers 涨幅 8-13%。2) DRAM: 2024 年第一季 DRAM 合约价季涨幅约 13~18%,其中 Mobile DRAM 持续领涨。目前观察,由于 2024 全年需求展望仍不明朗,故原厂认为持续性减产仍有其必要,以维持存储器产业的供需平衡。

图 28: 23Q4-24Q1 NAND FLASH 产品合约价涨跌幅预测

	4Q24	1Q24 (E)
Client SSD	up 13-18%	up 15-20%
Enterprise SSD	up 10-15%	up 18-23%
eMMC UFS	up 10-15%	up 18-23%
3D NAND Wafers (TLC & QLC)	up 35–40%	up 8-13%
Total NAND Flash	up 13-18%	up 15-20%

资料来源:全球闪存市场公众号,天风证券研究所

图 29: 23Q4-24Q1 DRAM 产品合约价涨跌幅预测

	4Q23	1Q24 (E)
PC DRAM	DDR4:up 8-13% DDR5:up 10-15% Blended ASP:up 10-15%	up 10-15%
Server DRAM	DDR4:up 5-10% DDR5:up 0-5% Blended ASP:up 8-13%	up 10-15%
Mobile DRAM	up 18-23%	up 18-23%
Graphics DRAM	up 8-13%	up 10-15%
Consumer DRAM	up 10-15%	DDR3:up 8-13% DDR4:up 10-15%
Total DRAM	up 13-18%	up 13-18%

资料来源:全球闪存市场公众号,天风证券研究所

CES2024-SK 海力士着重强调存储在 AI 时代发挥关键作用: SK 海力士在拉斯维加斯举行的 CES2024 期间举行了题为 "存储,人工智能的力量"的新闻发布会,SK 海力士社长兼 CEO 郭鲁正在会上阐述了 SK 海力士在人工智能时代的愿景。发布会上,郭社长表示,随着生成人工智能的普及,存储的重要性将进一步提高。他还表示,"SK 海力士正在向 ICT 行业提供来自世界最佳技术的产品,引领 "以存储为中心的人工智能无处不在"。郭社长在新闻发布会上提到: ICT 行业在 PC、移动和现在基于云的人工智能时代发生了巨大的发展。在整个过程中,各种类型和大量的数据都在生成和传播。现在,我们进入了一个建立在所有数据基础上的 AGI 新时代。因此,新时代将朝着 AGI 不断生成数据并重复学习和进化的市场迈进。在 AGI 时代,存储将在处理数据方面发挥关键作用。从计算系统的角度来看,存储的作用甚至更为关键。以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。这意味着人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。人工智能时代的存储方向应该是以最快的速度、最有效的方式和更大的容量处理数据。这与过去一个世纪的存储开发一致,后者提高了密度、速度和带宽。

三星、SK 海力士和美光存储三巨头将极大受益于消费电子的复苏。值得强调的是,在消费电子回暖的带动下,存储芯片在 23Q4 合约价报价优于市场预期。其中,DRAM 方面,DDR5 上涨 15~20%,DDR4 上涨 10~15%,DDR3 上涨 10%,涨幅优于原先预估的 5~10%;而在 NAND Flash 方面,目前每家厂商平均涨至少 20~25%,涨幅比 DRAM 更大。

表 7: 存储厂商受益于手机、PC 服务器复苏

类别	细分品类	企业	业务动态
存储	存储	三星	2024 年半导体投资同比增长 25%; 三星电子等 2023 年第四



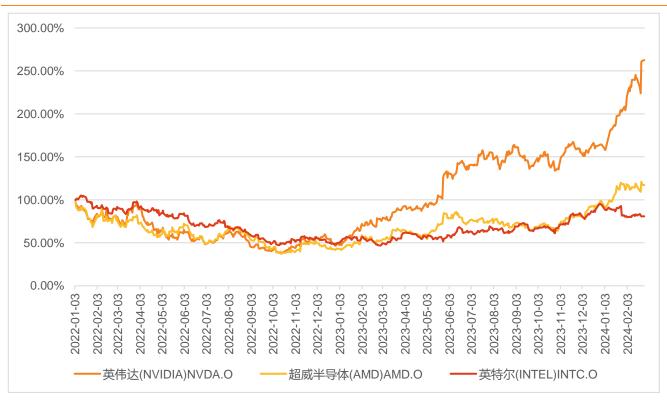
		季度向多家大型智能手机公司供应的移动 DRAM 价格上调了
		25%至 28%左右,这一幅度超出了市场预期
		Q3 的汽车收入创纪录新高;公司认为 DRAM 需求正在改善,
	美光	2024年HBM产能已全部售罄;计划2024年增加半导体投资,
	夫尤	同比增长 100%; 公司认为 2024 年和 2025 年存储价格将保持
		着强劲的势头
		Q3 服务器 DRAM 市场份额近 50%,Q3 销售额中 HBM 的占
	SK海力士	比达到了 20%; 2024 年增加半导体投资, 同比增长 100%; 公
		司指出,PC 市场随着渠道库存回归正常水位,加上明年换机
		需求提升,整体出货量有望实现约 5%增长

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

5.1.2. 数字芯片: 高通发布 MR 设备芯片 XR2+Gen 2, 重点关注 XR 市场相关标的

在过去的一个月(01.25-02.26)数字芯片国际厂商股价涨跌不一,其中英伟达/AMD/英特尔股价涨跌幅分别为+28.4%/-2.4%/-13%,联发科/高通/Skyworks/Qorvo 股价涨跌幅分别 +18.2%/+1.7%/-2.5%/+6.7%。

图 30: NVIDIA、AMD、INTEL 股价相对涨跌幅



资料来源: Wind, 天风证券研究所 注: 以 2022/1/3 股价为基准

图 31: 联发科、高通、思佳讯、Qorvo 股价相对涨跌幅





资料来源: Wind, 天风证券研究所 注: 以 2022/1/3 股价为基准

在计算芯片方面,根据研究机构 Jon Peddie Research 统计,2023 年第三季度,全球 PC GPU 出货量达到 7190 万个,环比增长 16.8%, PC CPU 出货量环比增长 15.2%。PC GPU 市场中,英伟达、英特尔、AMD 出货量均显著增长,其中 AMD 环比增长达 36.6%。市场份额方面,英伟达为 19%,英特尔为 64%,AMD 为 17%。目前个人电脑的 GPU 搭载率为 117%,比上季度增长 1.6%,这显示出搭载独立显卡的 PC 占比增加。此外,台式机独立显卡占比增长了 37.4%。专注智能手机 SoC 的高通、联发科、海思也将极大受益于消费电子的复苏。

表 8: 手机、PC、服务器复苏主要受益半导体品类及厂商

类别	细分品类	企业	业务动态
			英特尔将推出备受期待的 Meteor Lake 芯片,采用 Intel 4 制
		英特尔	程工艺,首次引入了针对人工智能加速的 NPU。此外,英特
	CPU/GPU		尔还正式启动首个 "AI PC 加速计划"
	CPU/GPU	AMD	AMD Ryzen 8000 系列 AM5 桌面处理器预计将于 2024 年推
		AIVID	出。新一代处理器预计将采用基于 Zen 5 架构的 CPU 核心。
		英伟达	英伟达推出三款带有额外组件的新型桌面级 GPU
		高通	公司看到全球手机需求稳定的早期迹象,预计2023年手机销
			量将同比下降中高个位数百分比,好于此前预期。受益于安
计算			卓渠道库存正常化、旗舰新机带动公司新品出货, 预 FY24Q1
			手机业务营收环比增长超 10%,其中来自中国手机客户的收
			入环比增长超 35%。
	手机 SoC	手机 SoC 联发科	Q3 营收季增 12.2%,预计 Q4 营收季增 9~15%; Q3 手机芯片
		妖汉件	出货量全球市场份额达 33%
			在高端智能手机 Mate 60 系列强势带动下,华为已将智能手
		海思	机 2024 年出货量目标定为 6000 万台至 7000 万台。在突破
		(日小小	美国封锁制裁后,随着海思各大业务逐步回归,海思有望重
			回全球前十大设计公司行列

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

根据 Counterpoint Research 的 《智能手机 360 报告》 对全球智能手机出货量的预测,预计 2023 年全球智能手机出货量将同比下降 5%,达到 12 亿台,为近十年最低水平。然而,预计第四季度出货量将同比增长 3%,达到 3.12 亿台。北美和欧洲的出货量预计将与去年持平。但中国和中东和非洲 (MEA)、印度等新兴市场成功扭转颓势,从 2023 年第



四季度起将成为智能手机市场的新增长引擎。

图 32: 202301-202311 中国手机出货量(万台,其中 11 月为 BCI 统计中国智能手机新机激活量)

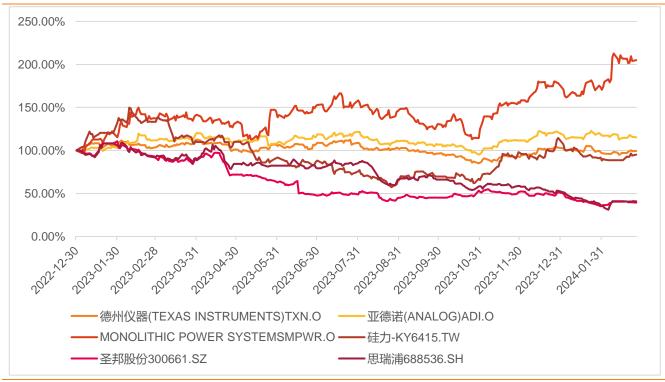


资料来源: Wind, 天风证券研究所

5.1.3. 模拟芯片: 国际大厂 23Q4 收入同比减少, 24Q1 展望营收或环比继续下行

在过去的一个月(01.25-02.26)模拟芯片厂商股价涨跌不一,大部份厂商股价上行。其中德州仪器/亚德诺/MPS/矽力杰/圣邦股份/思瑞浦近一月股价涨跌幅为-1.1%/-4.2%/+17.7%/+3.7%/+3.1%/-0.2%。

图 33: TI、ADI、MPS、Silergy、圣邦、思瑞浦股价相对涨跌幅



资料来源: Wind, 天风证券研究所 注:以 2022/12/30 股价为基准

部分汽车料仍缺货, TI 大部分物料的交期已恢复正常。热门型号 TMS320F28335PGFA 价格持续下跌,当前现货价格在 60-70 元左右。对于 TI 来说,现货市场整体还是低迷。TI 的逻辑器件和线性器件产品方面,在 8-20 周内供应持续改善。TI 的高速 ADC 系列、高精度运算放大器系列、隔离系列和高压和隔离电源系列产品的供应仍然紧张。另外,TI 对于工业类需求不太看好,目前处于库存调整阶段。

图 34: TMS320F28335PGFA 价格趋势







资料来源:正能量电子网,天风证券研究所

DDIC 随着 2023 年价格基本稳定或略有下降,随着电视、游戏显示器和商用笔记本电脑等大型应用出货量回升带动 DDIC 需求增加。但由于持续的市场压力,DDIC 价格预计将继续呈下降趋势。中国工厂的面板生产日益集中,使长期主导 DDIC 市场的中国台湾供货商面临巨大压力。根据 Trendforce 数据,2022 年至 2023 年,中国大陆 TV DDIC 市场份额持续增加,从 19.6%提升至 23.3%。

120.00% 100.00% 19.60% 23.30% 80.00% 60.00% 47.70% 51.50% 40.00% 20.00% 32.70% 25.20% 0.00% 2022 2023E ■韩国 ■中国台湾 ■中国大陆

图 35: TV DDIC 地区市占率

资料来源: Trendforce, 天风证券研究所

国际大厂 23Q4 收入同比减少,24Q1 展望营收或环比继续下行。国际模拟芯片大厂 TI、MPS 近期发布 23Q4 季报,各大厂商业绩在各自的下游应用领域表现均呈现下滑的态势,TI 的模拟领域营收为 31.20 亿美元,同比-12%,嵌入式处理领域实现营收 7.52 亿美元,同比-10%。

图 36: 国际模拟厂商 23Q4 业绩及下季度展望



			2	3Q4			24Q1
	营收 (百万美元)	同比	环比	净利润(百万美元)	同比	环比	23Q4指引
德州仪器TI	4077	-12.70%	-10.04%	1371	-30.12%	-19.78%	24Q1预计营收 指引中值36亿 美元,同比- 17.79%/环比- 13.25%。
亚德诺ADI	2716.5	-16.36%	-11.70%	498.4	-46.76%		24Q1预计营收 指引中值25亿 美元,同比- 21.67%/环比- 7.97%。
芯源MPS	454	-1.30%	-4.39%	96.9	-18.62%	-20.01%	24Q1预计营收 中值4.47亿美 元(4.37-4.57亿 美元),同比- 0.9%/环比- 1.54%。

资料来源: 各公司公告, 天风证券研究所

5.1.4. 功率器件: 国际功率大厂分部门营收受到下游需求分化明显

在过去的一个月(01.25-02.26)大部份功率器件厂商股价走低,仅小部分厂商股价出现上涨。 其中英飞凌/意法半导体/安森美/Wolfspeed/瑞萨电子/罗姆半导体近一月股价涨跌幅为 -3.5%/-1.6%/+6.7%/-25.3%/-4.1%/-2.4%。

图 37: 英飞凌、意法半导体、安森美、Wolfspeed、瑞萨、罗姆股价相对涨跌幅



资料来源: Wind, 天风证券研究所 注: 以 2022/1/3 股价为基准

中国汽车工业协会发布汽车产销数据。1-11 月,汽车产销分别完成 2711.1 万辆和 2693.8 万辆,同比分别增长 10%和 10.8%。预计 2023 年我国汽车总销量为 3000 万辆左右,其中乘用车销量为 2600 万辆左右,商用车销量为 400 万辆左右,新能源汽车销量为 940 万辆左右,出口量为 480 万辆左右。中汽协同时预测,2024 年我国汽车总销量为 3100 万辆左右,其中乘用车销量为 2680 万辆左右,商用车销量为 420 万辆左右,新能源汽车销量为 1150 万辆左右,出口量为 550 万辆左右。随着中国经济逐步恢复,根据中汽协预计,汽车市场需求将继续保持稳定增长,未来中国汽车市场将进入 3000 万辆级别的新阶段。

图 38: 新能源汽车销量(万辆)与同比增速





资料来源: Wind, 天风证券研究所

根据 Trendforce 数据,新能源汽车预计 2024 年成长率为 32%,总销售量预计将达到 1,700 万台。比亚迪在插电式混合动力车市场中保持领先地位,积极拓展品牌和产品组合。理想汽车凭借中国大型 SUV 需求的成长,取得第二名 (10%),实现了第一季销售超过 10 万辆的里程碑。

图 39: 23Q3BEV&PHEV 市占率

3Q23 BEV & PHEV Sales Ranking and Market Share

Rank	BEV	Market Share	PHEV	Market Share
1	Tesla	18.0%	BYD	35.2%
2	BYD	18.0%	Li Auto	10.0%
3	GAC Aion	5.8%	BMW	4.0%
4	Volkswagen	4.8%	Mercedes-Benz	3.9%
5	SAIC-GM-Wuling	4.6%	Deepal	3.6%
6	BMW	3.4%	Geely	3.4%
7.	Hyundai	2.6%	Volovo cars	3.4%
8	Mercedes-Benz	2.5%	Toyota	3.1%
9	NIO	2.3%	Denza	3.0%
10	Kia	2.1%	Jeep	3.0%

Note: The data are based on brands, and some data are estimated values.

Source: TrendForce, Nov., 2023

资料来源: Trendforce, 天风证券研究所

国际功率大厂分部门营收受到下游需求分化明显,国际大厂 Wolfspeed 预期 24Q1 营收环比微降,部分中高端产品或标准组件逐步面临价格压力。

图 40: 全球主要功率器件厂商 23Q3 业绩情况及后续展望

	23Q4			24Q1
	营收	同比	环比	24Q1指引
英飞凌	37.02亿欧元	-6.30%	-10.77%	24Q1营收: 36亿欧元,同比-12.62%/ 环比-2.76%。
ST	42.82亿美元	-3.21%	-3.50%	24Q1营收: 36亿美元,同比-15.23%/ 环比-15.93%。
安森美	20.18亿美元	-4.06%	-7.46%	24Q1营收:18.5 亿美元,同比- 5.60%/环比-8.33%。
Wolfspeed	2.08亿美元	19.91%	5.57%	24Q1营收:2 亿美元,同比-12.55%/ 环比-4.03%。



资料来源:各公司官网,天风证券研究所

5.1.5. 射频芯片:海外龙头 Q4 普遍出现稼动率提升、毛利率和营收同比增长

海外龙头 Q4 普遍出现稼动率提升、毛利率和营收同比增长。1)稳懋: 2023 年第四季合并营收为新台币 48.68 亿元,优于原先的预期,较前一季成长 17%,较去年同期成长 38%。除了 Wi-Fi 客户主要备货期已过之外,其余的产品皆有二位数成长,同时得力于产能利用率自上一季的 50%上升到 60%,使得第四季营业毛利率自上一季的 22.1%上升到 29.4%,营业净利率也自上一季的 1.7%回升到 13.1%; 2) Qorvo: 23Q4 营收实现同比增长,24Q1 公司营收指引中值 9.25 亿美元(9-9.5 亿美元),同比+46.20%/环比-13.87%。

图 41: 全球主要功率器件厂商 23Q4 业绩情况及后续展望

	23Q4			24Q1	
	营收	同比	环比	24Q1指引	
Qorvo	10.74亿美元	44.48%	-2.69%	24Q1公司营收指引中值9.25亿美元(9-9.5亿美元), 同比+46.20%/环比-13.87%	
稳懋	48.68亿新台币	38.00%	17.00%	展望第一季,预期营收将较前一季下滑 low-teens 百分比,毛利率则预期为 mid-twenties 的水平 。	

资料来源: 各公司官网, 天风证券研究所

5.1.6. CIS: 消费电子景气回暖及补库拉动业绩回升, 三星 CIS 24 年有望开启涨价

受益于安卓手机景气回暖、终端厂商库存去化及新机拉货需求带动,CIS 公司 Q3 普遍迎来业绩复苏。例如思特威、韦尔股份、格科微等本土 CIS 厂商业绩看: 思特威 Q3 营收 7.00 亿元,同比增长 8.58%,环比增长 13%;韦尔股份 Q3 营收 62.23 亿元,同比增长 44.35%,环比增长 37.58%;格科微 Q3 营收 12.93 亿元,同比增长 1.30%,环比增长 17.69%。三家均实现同环比双增,市场回暖已现端倪。同时,23 年 11 月底,三星向客户发出 CIS 涨价通知,明年一季度平均涨幅高达 25%,且个别产品涨幅最高上看 30%,成为本轮涨价幅度最大的芯片品类之一。

5.2. 代工: 先进制程需求增长, 台积电计划 2024 年底 3nm 产能提升至 80%

据 TrendForce 的数据, 随着终端及 IC 客户库存陆续消化至较为健康的水位,及 2023 下半年 iPhone、Android 阵营推出新机等有利因素,带动晶圆厂第三季智能手机、笔电相关零部件急单涌现。受此影响,2023 年第三季度全球十大晶圆代工厂商的产值合计达 282.9 亿美元,环比增长 7.9%,回暖迹象明显。在增幅上,除了联电、华虹、力积电 3 家公司营收环比下滑外,其余 7 家营收均环比增长。其中,英特尔以 34.1%的数据在 Q3 营收中增长幅度最大;而华虹在当季营收下跌幅度达 9.3%,下降幅度最大。

表 9: 23Q3 全球前十晶圆代工厂业绩及市场份额变化情况

排名	厂商名称	市场份额	3Q2023(百 万美元)	2Q2023(百 万美元)	环比增长
1	台积电(TSMC)	57.9%	17,249	15,656	10.2%
2	三星(Samsung)	12.4%	3,690	3,234	14.1%
3	格芯(GlobalFoundries)	6.2%	1,852	1,845	0.40%
4	联电(UMC)	6.0%	1,801	1,833	-1.7%
5	中芯国际(SMIC)	5.4%	1,620	1,560	3.8%
6	华虹集团 (Huahong Group)	2.60%	766	845	-9.3%
7	高塔半导体(Tower)	1.20%	358	357	0.3%
8	世界先进(VIS)	1.1%	333	321	3.8%
9	英特尔(IFS)	1.0%	311	232	34.1%
10	力积电(PSMC)	1.0%	305	330	-7.5%
	合计	95.0%	28,286	26,213	7.9%



资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

展望未来,TrendForce 认为,受半导体下行周期影响 2023 年全球晶圆代工市场规模约 1,120 亿美元,同比下滑 10-15%。不过,其也认为当前芯片库存水平已回归常态,2024 年个人电脑、智能手机、服务器等关键终端产品均有望呈现正向增长,拉动半导体需求。因此,TrendForce 判断 2Q24 前后全球晶圆代工市场有可能确立上行趋势,并预计 2024 年全球晶圆代工市场规模有望迎来 5-10%的增长。

表 10: 全球晶圆代工厂对未来行情的看法

公司名称	对未来行情的主要看法
台积电	2024 年将是实现健康增长的一年,目前已经看到智能手机需求出现企稳回暖的初步信号,但在未来 2-3 年,智
	能手机增速仍低于企业平均水平;汽车业务方面,台积电指出,过去三年汽车需求非常强劲,不过从 2023 年下
	半年开始,汽车已经进入库存调整模式。
联电	联电共同总经理王石认为第四季度 PC 与手机需求会与第三季度相当,两大应用领域近期有急单出现,研判这是
	早期显示库存修正到一定程度的迹象,但有些应用的库存修正会延续到明年。另外,车用客户自 2022 年开始累
	积的高库存,有望在第四季度消化至一定水位。
力积电	力积电总经理谢再居称,目前有感受到供应链库存降到合理水位,并观察到包括手机用驱动IC,以及监视系统
	采用的 CMOS 图像传感器(CIS)都有短单的需求,部分订单能见度甚至超过一个季度;另外,特殊存储产品单
	价也展现回升态势,正向看待第四季度业绩表现。
世界先进	世界先进的展望则较为保守,该公司预期第四季度半导体供应链谨慎控管库存,虽然消费电子库存调整接近尾
	声;但车用与工业较晚修正库存,预期第四季度仍有明显修正,估计第四季度晶圆出货量季减8%至10%,产品
	平均销售单价(ASP)估季减 2%内,毛利率将持续下滑到 22%至 24%。
三星	三星晶圆代工事业也受益于先进制程、高中低阶 5G APSoC、5G modem 及成熟制程 28nm OLED DDI 等订单加
	持,推动其第三季度营收环比增长 14.1%至 36.9 亿美元。
格芯	格芯 Q1 和 Q2 产能利用率从 85%上升至 88%,由于格芯能承接来自美国航天、国防、医疗等特殊领域芯片代工,
	及车用相关订单与客户签订长约) (LTA) 而较为稳定,有效支撑格芯产能利用率。格芯 CEO ThomasCaulfield
	在财报中表示,虽然全球经济及地缘政治仍充满不确定性,我们持续与客户密切合作,协助客户去化库存。
英特尔	受益于下半年笔记本电脑拉货季节性因素,加上拥有先进制程,英特尔 IFS 第三季营收环比增长 34.1%至约 3.1
	亿美元,市场份额为 1%,自 Intel 财务拆分后排名首次进入全球前十
高塔半导体	高塔半导体受益于季节性因素,智能手机、车用/工控领域半导体需求相对稳定,第三季营收约 3.6 亿美元,大
	致与第二季持平,微幅增长 0.3%,市场份额为 1.2%
中芯国际	中芯国际联席 CEO 赵海军表示,在手机消费和工业控制领域,中国客户基本上达到了进出平衡的库存水平。但
	欧美客户依然处于历史高位。其次,汽车产品的相关库存开始偏高,正在引起客户对市场修正的警觉,下单开
	始迅速收紧。还有,三季度手机终端市场出现回暖迹象,整体行业认为明年整体消费电子会有回暖行情。
华虹公司	展望 2023 年第四季度,华虹半导体预计销售收入约在 4.5 亿美元至 5.0 亿美元之间,预计毛利率约在 2%至 5%
	之间。产能方面,截至第三季度末,华虹半导体折合8英寸晶圆月产能增加至35.8万片,总体产能利用率为86.8%。

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

1月,终端客户订单前景依然不明朗,整体产能利用率仍面临下行压力。

图 42: 主要晶圆代工厂动态



厂商	1月动态	2月价格趋势
台积电	扩大CoWoS封装产能;计划2024年底3nm产能 提升至80%	稳定
三星	晶圆代工报价调降5%-15%	下降
联电	新加坡22nm新厂年中完工	下降
中芯国际	或降价抢单	下降
格芯	Q1降幅高达15%-20%	稳定
世界先进	目前市场能见度约2-3个月	下降
力积电	2024 年AI、电动车将现跳跃式成长	下降
华虹	无锡七厂一期扩产完毕	下降

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

5.3. 封测: 先进封装需求供不应求, 行业复苏趋势明显

1月,行业产能利用率低迷,订单有所好转。根据芯八哥预计,日月光 2023 年平均产能利用率约为 60-65%, 24 年 1 月产能利用率为 60-65%, 预计 2 月订单上升。长电科技 1 月产能利用率约 70-80%, 预计 2 月订单维持稳定。通富微电 AI 相关订单上升,1 月产能利用率达 75-85%, 预计 2 月订单维持稳定。华天科技需求有复苏迹象,1 月产能利用率也达到 85%。

图 43: 主要封测厂商动态

厂商	1月动态	2月订单预测
日月光	2023年平均产能利用率约为60~65%	上升
长电科技	23Q4订单恢复2023年同期水平	稳定
通富微电	AI相关订单上升	稳定
华天科技	需求有复苏迹象	下降
气派科技	拓展第三代半导体和功率器件封测品类	下降
中小封测厂	订单波动	下降

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

AI 需求全面提升,带动先进封装需求提升,台积电启动 CoWoS 大扩产计划。今年一季度以来,市场对 AI 服务器的需求不断增长,加上 Nvidia 的强劲财报,造成台积电的 CoWoS 封装成为热门话题。据悉,Nvidia、博通、谷歌、亚马逊、NEC、AMD、赛灵思、Habana 等公司已广泛采用 CoWoS 技术。台积电董事长刘德音在今年股东会上表示,最近因为 AI 需求增加,有很多订单来到台积电,且都需要先进封装,这个需求远大于现在的产能,迫使公司要急遽增加先进封装产能。

Chiplet/先进封装技术有望带动封测产业价值量提升,先进封装未来市场空间广阔。据 Yole 分析, 先进封装 (AP) 收入预计将从 2022 年的 443 亿美元增长到 2028 年的 786 亿美元, 年复合增长率为 10%。在封装领域, 2.5D、3D Chiplet 中高速互联封装连接及 TSV 等提升封装价值量, 我们预测有望较传统封装提升双倍以上价值量, 带来较高产业弹性。

业绩端来看,根据各公司第三季度报告,可以显著发现各公司营收均有环比改善,归母净



利润环比改善或跌幅收窄,整体呈缓慢复苏态势。

图 44: 主要封测企业 23Q3 业绩 (营收、归母净利润)环比显著改善 (%) (环比数据)

		22Q1	22Q2	22Q3	22Q4	23Q1	23Q2	23Q3
长电科技	营收	-5.21%	-8.39%	23.19%	-2.18%	-34.77%	7.73%	3 0.79%
以电行义	归母净利润	2.14%	-20.79%	3 3.28%	-14.30%	-85.88%	250.91%	23.83%
通富微电	营收	-2.32%	<mark>1</mark> 2.51%	1 3.56%	6.21%	-24.01%	1 3.44%	1 3.92%
地苗城电	归母净利润	-35.04%	<mark>2</mark> 1.82%	-44.78%	- 77.48%	-80.00%	-3940.00%	164.58%
华天科技	营收	-6.87%	6.82 <mark>%</mark>	-9.55%	-4.37%	-19.43 <mark>%</mark>	27.29%	4.56%
十八十八	归母净利润	-46.6 <mark>5</mark> %	48.31 <mark>%</mark>	-38.11 <mark>%</mark>	-73.6 <mark>8%</mark>	-312.00%	-259.43%	-88. 17 %

资料来源: Wind, 天风证券研究所

5.4. 设备材料零部件: 1月,可统计设备中标数量 27台,招标数量 27台

1月,硅晶圆需求低迷,设备需求相对稳定,关注设备出口管控变化。

图 45: 半导体设备及硅晶圆头部企业情况

类型	企业	1月订单	1月库存	2月订单预测
	ASML	上升	低	上升
	AMAT	稳定	低	稳定
	泛林	稳定	低	稳定
设备	TEL	稳定	低	稳定
	科磊	稳定	低	稳定
	北方华创	上升	低	上升
	中微公司	上升	低	上升
	信越化学	下降	一般	下降
	Sumco (胜高)	下降	一般	下降
硅晶圆	环球晶圆	下降	较高	下降
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降
	沪硅产业	上升	一般	上升

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

5.4.1. 设备及零部件中标情况: 1月可统计设备中标数量同比出现下滑

2024 年 1 月,可统计设备中标数量 27 台,同比-46%,其中薄膜沉积设备中标 2 台,同比-50%;辅助设备 1 台,同比持平;检测设备 2 台,同比-93.10%;刻蚀设备 7 台,同比+75%。

图 46: 2024 年 1 月部分国内企业可统计中标情况(台)

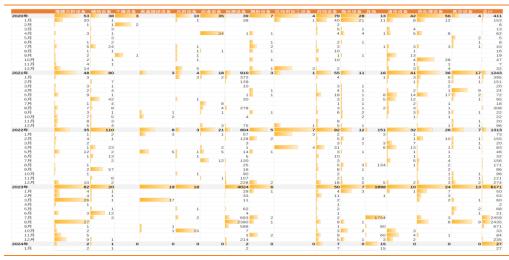
	薄膜沉积设备	辅助设备	检测设备	刻蚀设备	其他	À	总计
北方华创	2	2			7	15	24
精测半导体				1			1
上海精测				1			1
上海正帆科技股份有限公司			1				1
总计	2	2	1	2	7	15	27

资料来源: 千里马招标网,天风证券研究所 注: 统计数据或不完善,具体以各公司官方披露为准

2024 年 1 月,北方华创可统计中标设备 24 台,同比+100%。其中,薄膜沉积设备 2 台,同比+100%;刻蚀设备 7 台,同比+600%;其他设备 15 台。

图 47: 2020-2024.1 北方华创可统计中标情况(台)

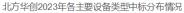


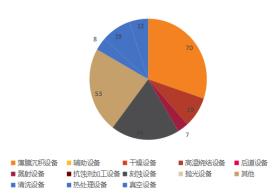


资料来源: 千里马招标网, 天风证券研究所 注: 统计数据或不完善, 具体以各公司官方披露为准

图 48: 2023 年北方华创各主要设备类型中标分布情况(台)

图 49: 2024 年 1 月北方华创各主要设备类型中标分布情况(台)





资料来源: 千里马招标网, 天风证券研究所 注: 统计数据或不完善, 具体以各 公司官方披露为准

北方华创2024年1月各主要设备类型中标分布情况



资料来源: 千里马招标网, 天风证券研究所 注: 统计数据或不完善, 具体以各 公司官方披露为准

2024 年 1 月,国内半导体零部件可统计中标共 14 项,同比-54.84%。主要为电气类 10 项, 为北方华创、英杰电气中标,机械类1项,为菲利华中标,气液。真空系统类3项,为汉 钟精机、北京北方华创真空技术有限公司中标 。

图 50: 2011-2024.1 国内半导体设备零部件可统计中标情况(台)



	电气类	北	却由—休米	扣械米	气液/真空系统类	心哭心表米	单计
北方华创	54	九丁夫	THE PARK	-Drhre	2	人間以水关	56
2021年					1		1
2022年	1				1		2
2023年	47				_		47
2024年	6						6
北方华创旗下七星流量计						1	
2023年						1	
北广科技	6						6
2013年	1						1
2016年	1						1
2020年	1						1
2021年	3						3
北京北方华创真空技术有限公司	3				3		6
2023年	3				2		5
2024年					1		1
菲利华(湖北)		1		19	1		21
2018年				1			1
2020年		1		2	1		4
2021年				6			6
2022年				6			6
2023年				3			3
2024年				1			1
菲利华 (上海)				4			4
2023年				3			3
2022年				1			1
富创精密				1	2		3
2021年					1		1
2022年			40	1			2
汉钟精机	3		42		6		51
2019年					1		1
2021年					1		1
2022年	1		5		1		7
2023年	2		37		1		40
2024年					2		2
华卓精科	1		6	1			8
2022年			3				3
2023年	1		3	1			5
英杰电气	116	1		3	1		121
2011年	2						2
2013年	1						1
2014年	1						1
2015年	7						7
2016年	3						3
2017年	3						3
2018年	7						7
2019年	9				1		10
2020年	10	1					11
2020年	18						18
2022年	20			_			20
2023年	31			3			34
2024年	4						4
中国科学院微电子研究所	3						3
2019年	1						1
2020年	1						1
2023年	1						1
总计	186	2	48	28	15	1	280

资料来源: 千里马招标网,天风证券研究所 注: 统计数据或不完善,具体以各公司官方披露为准

2024年1月,国外半导体零部件可统计中标共21项,同比-40.00%。主要为光学类8项,机械类2项,电气类1项,气液/真空系统类10项。分公司来看,Newport和蔡司可统计中标零部件最多,为5项,Pfeiffer2项,ElliottEbara Singapore4项,EBARA1项,Inficon1项,VAT2项,MKS1项。

图 51: 2011-2024.1 国外半导体设备零部件可统计中标情况(台)



	电气类	光学类	几电一体类	机械类	气液/真空系统类	总
Advanced Energy	14					
2015年	1					
2017年	2					
2018年	3					
2019年	1					
2020年	3					
2021年	3					
2022年	1					
Brooks			2		21	:
2014年			1			
					1	
2017年			1		1	
2018年					1	
2019年					5	
2021年					4	
2022年					7	
2023年					3	
		2			J	
Cymer						
2017年		1				
2018年		1				
BARA				1	33	
2014年					4	
2018年					3	
2019年					4	
2020年					2	
2021年				1	7	
2022年					5	
2023年					7	
2024年					1	
					21	
lliott Ebara Singapore						
2019年					1	
2022年					4	
2023年					12	
2024年					4	
errotec			2			
2021年			1			
2022年			1			
			1			
nficon		1		1	44	
2018年					1	
2019年					1	
2021年				1		
2022年				_	5	
2023年		1			36	
2024年					1	
ИKS	15	4			39	
2012年					1	
2015年					3	
2017年	2				7	
2018年					5	
2019年	2				7	
2020年		1			3	
2021年	5				8	
2022年	3					
2023年	2	3			5	
2024年	1				J	
	1					
/IKS、Inficon					1	
2018年					1	
/IKS、VAT					1	
2020年					1	
lewport	1	83		21	1	1
2022年	1	8			1	•
	1			10	1	
2023年		72		19		
2024年		3		2		
feiffer					141	1
2015年					5	
2016年					5	
2017年					4	
					8	
2018年						
2019年					7	
2020年					21	
2021年					19	
2022年					26	
2023年					44	
2024年					2	
feiffer、VAT					2	
2020年					2	
AT					25	
2011年					1	
2017年					1	
					3	
2018年						
2019年					2	
2020年					1	
2021年					1	
					5	
					9	
2022年						
2022年 2023年					2	
2022年 2023年 2024年	1	151			2	1
2022年 2023年 2024年		2				
2022年 2023年 2024年		2				
2022年 2023年 2024年 转司 2017年						
2022年 2023年 2024年 转司 2017年 2019年	1	3				
2022年 2023年 2024年 转司 2017年 2019年 2020年		3 6				
2022年 2023年 2024年 转司 2017年 2019年		3				
2022年 2023年 2024年 終司 2017年 2019年 2020年		3 6			2	
2022年 2023年 2024年 美司 2017年 2019年 2020年 2021年 2022年		3 6 4			2	
2022年 2023年 2024年 表司 2017年 2019年 2020年 2021年		3 6 4 37			2	

资料来源: 千里马招标网,天风证券研究所 注: 统计数据或不完善,具体以各公司官方披露为准



5.4.2. 设备招标情况: 1月可统计设备招标数量 27 台,同比-46%

2024 年 1 月,可统计设备中标数量 27 台,同比-46%,其中薄膜沉积设备中标 2 台,同比-50%;辅助设备 1 台,同比持平;检测设备 2 台,同比-93.10%;刻蚀设备 7 台,同比+75%。

图 52: 2024年1月部分国内企业可统计招标情况(台)

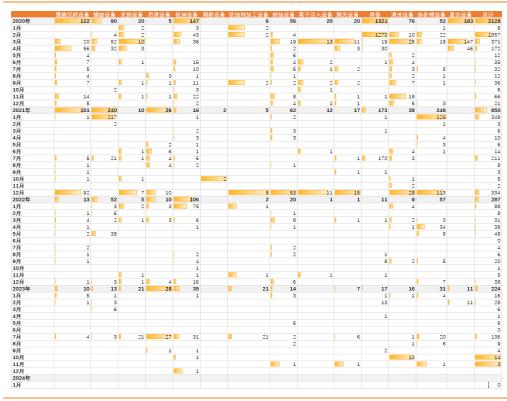
	辅助设备	检测设备	其他	清洗设备	热处理设备
上海积塔半导体有限公司	16	104	161	98	590
总计	4	116	1	81	1

资料来源: 千里马招标网, 天风证券研究所 注: 统计数据或不完善, 具体以各公司官方披露为准

2024年1月,华虹华力可统计招标设备共0台。

2020-2024年1月,华虹华力可统计招标设备共3589台,包括246台薄膜沉积设备、395台辅助设备、56台光刻设备、69台后道设备、304台检测设备、152台刻蚀设备、388台热处理设备等。

图 53: 2020-2024.1 华虹华力可统计招标情况(台)



资料来源: 千里马招标网, 天风证券研究所 注: 统计数据或不完善, 具体以各公司官方披露为准

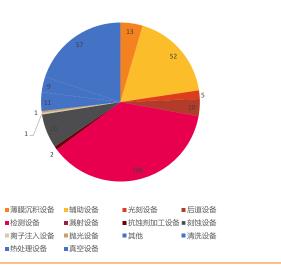
图 54: 2022 年华虹华力各主要设备类型中标分布情况(台)

图 55: 2023 年华虹华力各主要设备类型中标分布情况(台)

公司官方披露为准

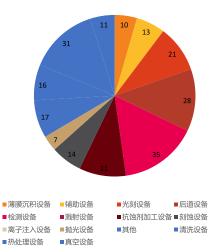


华虹华力2022年主要设备类型招标分布



资料来源: 千里马招标网, 天风证券研究所 注: 统计数据或不完善, 具体以各

华虹华力2023年主要设备类型招标分布



资料来源: 千里马招标网,天风证券研究所 注: 统计数据或不完善,具体以各公司官方披露为准

5.5. 分销商:整体分销市场需求逐步回升,2024年行业复苏可期

1月,分销商需求持续回升,库存得到优化,业绩有改善。

图 56: 主要元器件分销商最新动态

厂商	1月动态
大联大	2023营收6721,8亿新台币,年减13.4%
文晔科技	23Q4营收1897亿新台币,季增13.41%
中电港	客户涵盖国内电子信息行业头部企业
香农芯创	获无锡国资投资入局
商络电子	新能源客户包括阳光电源、西门子及禾迈等
雅创电子	2023年底以来订单有改善迹象
好上好	库存持续改善

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

6. 终端应用:看好消费电子复苏,关注元宇宙发展走势

6.1. 消费电子: 1月 AI 成 PC 市场新增长点, 关注苹果 MR 新品对供应链影响

基于 Q3 季度的良好市场反馈,业内机构普遍看好 2024 年的行情。其中,在手机领域,根据 IDC 预测,2023 年全球智能手机出货量将同比下降 1.1%至 11.9 亿部,2024 年全球智能手机出货量将同比增长 4.2%至 12.4 亿部;在折叠手机领域,根据 Counterpoint,2023 年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长 52%达 2270 万部,预计在 2024 年进入折叠屏手机的快速普及期,2025 年将达 5500 万部;在 PC 领域,根据 IDC 的数据,23Q3 全球 PC 出货量为 6820 万台,环比增长 11%,出货量已经连续两个季度环比增长。据其预测,PC 销量在 2023 年急剧下降 14%后,在 2024 年将增长 4%;而在笔电领域,据 TrendForce的数据,2023 年三季度,全球笔记本出货量已经连续两个季度实现环比增长。据其预测,2024 年全球笔记本市场整体出货规模将达 1.72 亿台,年增 3.2%。

表 11: 业内机构普遍看好 2024 年消费电子行业的发展

主要品类	预测情况
丰 机.	根据 IDC 预测, 2023 年全球智能手机出货量将同比下降 1 1%至 11 9 亿部, 2024



年全球智能手机出货量将同比增长 4.2%至 12.4 亿部。

	根据 Counterpoint,2023 年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长 52%
折叠手机	达 2270 万部,预计将在 2024 年开始进入折叠屏手机的快速普及期,2025 年
	将达 5500 万部。
	根据 IDC 的数据,2303 全球 PC 出货量为 6820 万台,环比增长 11%,同比降
PC	幅收窄至 8%,PC 出货量连续两个季度环比增长,市场出现好转迹象。IDC
	预计 PC 销量在 2023 年急剧下降 14%后,在 2024 年将增长 4%
	据 TrendForce 的数据,2023 年三季度,全球笔记本出货 量实现连续两个季
笔电	度的环比增长,同比降幅持续收窄。据其预测,2024年全球笔记本市场整体
	出货规模将达 1.72 亿台,年增 3.2%。

资料来源: 芯八哥公众号, 天风证券研究所

1月,整体市场需求持续恢复,AI成PC市场新增长点,关注苹果MR新品对供应链影响。

表 12: 消费电子厂商最新动态

类别	企业	1月动态			
	苹果	2023 年首次超过三星登顶智能手机年度销冠			
	三星	2023 年手机出货量 2.266 亿部,市场份额为 19.4%			
智能手机	华为	折叠手机大幅追单			
白化士心	OPPO	2023 年手机出货量 1 亿部			
	传音	2023 年手机出货量进入全球前五			
	荣耀	2023 年中国市场智能手机出货量第二			
	联想	AI PC 上市加速			
PC	宏基	看好 AI 相关产品增长			
	戴尔	2023 年 PC 销量暴跌 20%			
	Meta	对 AI 部门进行大规模改组			
VR/AR	苹果	Vision Pro 头显美国发售			
	HTC	VR 业务发展缓慢			

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

6.2. 新能源汽车:强者恒强,行业进入加速洗牌期

1月,新能源汽车行业"强者恒强",行业进入加速洗牌期。

表 13: 新能源汽车厂商最新动态

厂商	1月动态
比亚迪	2023 年汽车销量达 302.44 万辆;拟投入 1000 亿元发力自动驾驶
特斯拉	2023 年汽车销量达 181 万辆
本田	与通用合作电车拟 3 月北美上市
大众	在华主要燃油车均向新能源转型
宝马	在华纯电产品增至 7 款
奔驰	2024 年推出 15 款新车
丰田	预计纯电动汽车市占率最多 30%
福特	宣布关停全部电车生产
Stellantis	意大利工厂裁员约 2250 人
广汽埃安	拟赴港上市
吉利	2023 年新能源车同比增长 51%
奇瑞	计划进军英国市场
理想	开启了新一轮产品降价



长城2023 年新能源车销售 26.2 万辆,同比增长 98.74%华为与东风岚图达成战略合作

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

6.3. 工控: 工控行业订单低迷, 国产品牌市占率提升

1月,工控行业订单低迷,国产品牌市占率提升。

表 14: 工控厂商最新动态

厂商	1月动态
施耐德	部分 Ethernet 产品价格上调 5%-20%
西门子	Q1 财季业绩将好于市场预期
汇川技术	国产产品市占率不断提升
英威腾	订单稳定,产能充足
禾川科技	国内工控市场竞争日趋激烈
埃斯顿	开发汽车等增量市场
新时达	整体库存较高

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

6.4. 光伏: 光伏行业市场供大于求, 库存去化仍在持续

1月,光伏行业市场供大于求,库存去化仍在持续。

表 15: 光伏厂商最新动态

	1
厂商	1月动态
阳光电源	2023 年净利润或超百亿
天合光能	2023 年光伏组件出货量约 70GW;光伏行业面临供大于求问题
锦浪科技	预计 2024 年海外逆变器业务占比 60%
固德威	较为依赖美国等海外市场
德业股份	欧洲逆变器库存较少,但行业库存仍处于去化过程中
昱能科技	欧洲库存相对较高

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

6.5. 储能: 行业库存问题仍存在,终端需求维持乐观预期

1月,行业库存问题仍存在,终端需求维持乐观预期。

表 16: 储能厂商最新动态

厂商	1月动态
阳光电源	2023 年储能业务海外收入占比超过 80%
科士达	欧洲市场竞争日趋激烈
上能电气	公司库存改善明显
科陆电子	子公司与斯特拉签署电池储能系统采购订单
德业股份	2024 年储能逆变器营收有望超 40 亿元
锦浪科技	Q1 欧洲市场库存问题仍存在
特斯拉	2023 年储能装机量同比增长 125%
科华数据	积极布局美国等海外储能市场

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

6.6. 服务器: AI 服务器及上游核心芯片需求维持稳定,看好 2024 年市场增长

1月, AI 服务器及上游核心芯片需求维持稳定,看好 2024 年市场增长。

表 17: 服务器厂商最新动态



企业	1月动态
英伟达	H20 特供芯片或 2024Q2 量产
AMD	MI300 系列 24 年或出货 40-60 万颗
浪潮	AI 服务器订单稳定增长
纬创	服务器营收占比已经超过三成
广达	乐观看待未来 AI 服务器需求
工业富联	2024-2026 年公司 AI 服务器或维持 20%-30%的高增长

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

6.7. 通信: 通信相关需求低迷, 预计今年市场需求进一步下滑

1月,通信相关需求低迷,预计今年市场需求进一步下滑。

表 18: 通信厂商最新动态

企业	1月动态
爱立信	预计 2024 年 5G 设备需求将下滑;或进一步裁员
中兴通讯	积极布局 5G-A 相关设备
诺基亚	23Q4 可比营业利润同比下降 27%
烽火通信	积极进行 6G 相关产品和技术的预研和布局

资料来源:芯八哥公众号,天风证券研究所

7. 本周海外半导体行情回顾

上周(02/24-03/02)海外各重点指数涨跌不一,绝大部份小幅震荡,费城半导体指数增幅最大。其中 SOX Index 涨幅最大为 6.8%,HSLI Index 跌幅最大为 0.9%。费城半导体指数表现优于其余指数。

图 57: 上周海外重点指数对比(%)

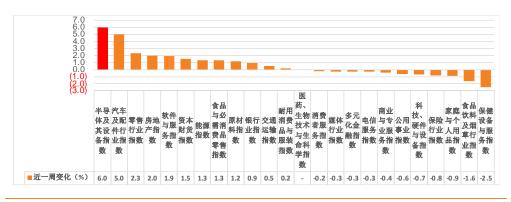


资料来源: Bloomberg, 天风证券研究所

上周(02/24-03/02) 标普 500 行业指数有涨有跌,半导体及其设备指数领涨。其中半导体及其设备指数涨幅最大为 6.0%,保健设备与服务指数跌幅最大为 2.5%。半导体及其设备指数表现优于其余标普 500 行业指数。

图 58: 上周标普 500 行业指数对比(%)





资料来源: Bloomberg, 天风证券研究所

8. 本周(02/26-03/01)半导体行情回顾

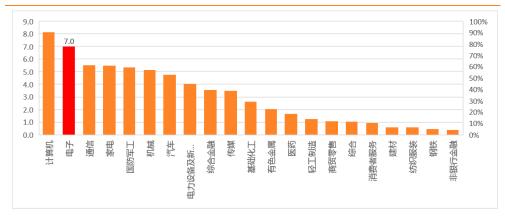
上周(02/26-03/01)半导体行情优于所有主要指数,领跑趋势明显。上周创业板指数上涨 3.74%,上证综指上涨 0.74%,深证综指上涨 4.03%,中小板指上涨 4.37%,万得全 A 上涨 2.42%,申万半导体行业指数上涨 8.44%,半导体行业指数行情优于所有主要指数。

表 19: 上周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅(%)	半导体行业相对涨跌幅(%)
创业板指数	3.74	4.70
上证综合指数	0.74	7.70
深证综合指数	4.03	4.41
中小板指数	4.37	4.07
万得全 A	2.42	6.03
半导体(申万)	8.44	-

资料来源: Wind, 天风证券研究所

图 59: 上周 A 股各行业行情对比(%)

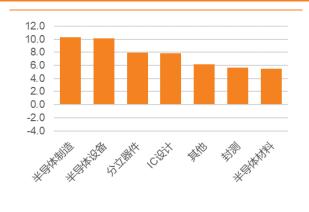


资料来源: Wind, 天风证券研究所

半导体各细分板块涨幅明显,其他板块领涨,半导体制造涨幅最低。半导体细分板块中,IC 设计板块上周上涨 7.9%,半导体材料板块上周上涨 5.5%,分立器件板块上周上涨 8.0%,半导体设备板块上周上涨 10.1%,封测板块上周上涨 5.7%,半导体制造板块上周上涨 10.3%。

图 60: 上周子版块涨跌幅(%)





资料来源: Wind, 天风证券研究所

上周半导体板块涨幅前 10 的个股为: 赛微微电,成都华微,大族数控,德明利,创耀科技,金海通,盛科通信-U,佰维存储,寒武纪-U,钜泉科技。

上周半导体板块跌幅前 10 的个股为: 芯联集成-U, 复旦微电, 力芯微, 华岭股份, 杰华特, 芯源微, 北京君正, 沪硅产业, 华天科技, 扬杰科技。

表 20: 上周涨跌幅前十半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅%	本周跌幅前 10	涨跌幅%
赛微微电	19.99	芯联集成-U	-9.24
成都华微	13.72	复旦微电	-2.89
大族数控	9.29	力芯微	-2.57
德明利	7.43	华岭股份	-2.33
创耀科技	7.29	杰华特	-2.19
金海通	7.01	芯源微	-2.15
盛科通信-U	6.88	北京君正	-2.07
佰维存储	6.72	沪硅产业	-1.52
寒武纪-U	6.65	华天科技	-1.47
钜泉科技	6.54	扬杰科技	-1.23

资料来源: Wind, 天风证券研究所

9. 本周(02/26-03/01) 重点公司公告

【立昂微 605358.SH】

回购股份减少注册资本:公司回购股份将用于减少注册资本,回购资金总额不低于人民币6,000万元(含),不超过人民币12,000万元(含),回购价格不超过人民币30元/股(含),回购资金来源为公司自有资金。

【银河微电 688689.SH】

公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年确认的各项减值准备合计为 1,334.04 万元。

【银河微电 688689.SH】

业绩快报:报告期内,公司实现营业总收入69,526.51万元,同比增加2.86%;实现归属于母公司所有者的净利润6,407.56万元,同比减少25.82%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,222.58万元,同比减少49.20%。报告期末,公司财务状况良好,总资产198,743.39万元,较报告期初增加4.40%;归属于母公司的所有者权益131,773.22万元,较报告期初增加2.66%。



【泰凌微 688591.SH】

公司新增全资子公司宁波泰芯微电子有限公司为募集资金投资项目"研发中心建设项目"的实施主体,以上募投项目实施地点相应由上海调整为上海、宁波。

【泰凌微 688591.SH】

于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨推动公司"提质增效重回报":本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励,以及维护公司价值及股东权益并用于出售。回购资金总额不低于人民币7,500.00万元(含)、不超过人民币15,000.00万元(含)。

【万业企业 600641.SH】

2024年2月27日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份741,100股,已回购股份占公司总股本的比例为0.08%,回购成交的最高价为13.45元/股,最低价为12.88元/股,支付的资金总额为人民币9,775,472元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

【雅创电子 301099.SZ】

于以集中竞价交易方式首次回购公司股份:公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月,使用不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元的自有资金,回购价格不超过人民币40元/股,以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票,择机用于实施员工持股计划或股权激励。

【通富微电 002156.SZ】

公司于近日完成了注册资本及法定代表人工商变更登记手续,并换领了新的营业执照,现公司法定代表人为石磊先生,注册资本为1,516,825,349元。

【甬矽电子 688362.SH】

以集中竞价交易方式回购公司股份:本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购股份的价格不超过人民币31.53元/股(含)。

【奕瑞科技 688301.SH】

业绩快报:报告期内,公司实现营业收入 1,885,551,967.01 元,同比增加 21.72%;实现归属于母公司所有者的净利润 618,662,209.80 元,同比减少 3.53%,主要系交易性金融资产公允价值变动影响所致;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 599,303,180.25 元,同比增加 15.97%。

【江丰电子 300666.SZ】

业绩快报:报告期内,公司实现营业收入257,631.03万元,较上年同期增长10.80%;营业利润25,667.32万元,较上年同期下降14.20%;利润总额为25,418.36万元,较上年同期下降13.65%;归属于上市公司股东的净利润为23,184.66万元,较上年同期下降12.08%。

【立昂微 605358.SH】

以集中竞价交易方式首次回购公司股份:2024年2月28日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份220,000股,占公司目前总股本比例为0.0325%,回购的最高价为23.81元/股、最低价为22.70元/股,已支付的总金额为5,149,527元(不含交易费用)。

【晶方科技 603005.SH】

以集中竞价交易方式回购公司股份的方案:本次回购资金总额不低于人民币 1500 万元(含) 且不超过人民币 2500 万元(含)。按回购金额上限 2500 万元(含)、回购价格上限每股 25.93 元进行测算,若全部以最高价回购,预计回购股份数量约为 96.41 万股,约占公司



目前总股本的 0.15%。

【聚辰股份 688123.SH】

以集中竞价交易方式回购股份:公司拟采用集中竞价交易的方式回购股份并减资注销,回购资金总额人民币5,000万元(含)至10,000万元(含);回购价格:不超过人民币70元/股(含)。

【雅创电子 301099.SZ】

截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份累计数量 80,000股,占公司当前总股本 80,000,000股比例为 0.10% 最高成交价为 37.71元/股,最低成交价为 34.07元/股,交易总金额为 2,861,754.00元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律、行政法规的要求,符合公司既定的回购方案。

【江丰电子 300666.SZ】

截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 762,300 股,占公司目前总股本的比例为 0.2872%,成交的最低价格为人民币 39.70元/股,成交的最高价格为人民币 59.80元/股,支付的总金额为人民币 39,992,680.11元(不含交易费用),本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

【敏芯股份 688286.SH】

截至 2024 年 2 月 29 日,苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 131,569 股,占公司总股本55,887,596 股的比例为 0.2354%,回购成交的最高价为 44.96 元/股,最低价为 35.09 元/股,支付的资金总额为人民币 4,947,592.54 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

【汇成股份 688403.SH】

截至 2024 年 2 月 29 日,合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")已累计回购股份 10,447,004 股,占公司总股本的比例约为 1.25%,购买的最高价为 8.80 元/股、最低价为 7.81 元/股,已支付的总金额为 87,652,064.90 元(不含交易费用)。

【万业企业 600641.SH】

截至 2024 年 2 月 29 日,上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,266,454 股,占公司总股本的比例为 0.24%,购买的最高价为 14.12 元/股,最低价为 12.88 元/股,已支付的总金额为人民币 30,467,821.12 元(不含 印花税、交易佣金等交易费用)。

【翱捷科技 688220.SH】

截至 2024 年 2 月 29 日,翱捷科技股份有限公司(以下简称"公司")通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 9,676,874 股,占公司总股本 418,300,889 股的比例为 2.3134%,回购成交的最高价为 83.80 元/股,最低价为 39.00 元/股,支付的资金总额为人民币 677,765,544.42 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

【天岳先进 688234.SH】

截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 738,701 股,占公司总股本的比例为 0.1719%,购买的最高价为 61.15 元/股、最低价为 43.96 元/股,支付的金额为人民币 40,353,042.51 元 (不含印花税、交易佣金等交易费用)。

【东芯股份 688110.SH】

截至 2024 年 2 月 29 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购公司股份 3,218,219 股,占公司总股本 442,249,758 股的比例为 0.7277%,回购成 交的最高价为 38.77 元/股,最低价为 22.80 元/股,支付的资金总额为人民币 100,062,741.68 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。



10. 本周(02/26-03/01)半导体重点新闻

被判无罪,福建晋华赢得美国司法部诉讼。在美国商务部将福建晋华集成电路有限公司列为对国家安全构成威胁的黑名单五年多后,美国旧金山地区法官 Maxine M. Chesney 经过非陪审团审判后裁定该公司无罪。其最新的裁决可能会缓和拜登政府为保护美国技术而采取的积极起诉行动。回顾该案件,早期美光科技在美国加州联邦法庭起诉联电与福建晋华,称联电通过美光员工窃取其知识产权,包括存储芯片的关键技术,并交由福建晋华,该行为侵害美光的商业秘密。最终法官的结论是,美国检察官未能证明福建晋华盗用了美国最大存储芯片制造商美光科技公司的专有数据。

英特尔表示将进军 Arm 芯片领域。2 月 27 日消息,近日在接受 Tom's Hardware 采访时,英特尔代工负责人斯图尔特·潘表示将会进军 Arm 芯片,并不断追赶台积电的代工市场份额。英特尔希望在 2030 年成为全球第二大代工厂,并希望能成为一家有弹性的代工厂,能够缓解地缘政治、战争冲突等各种问题导致的供应链中断问题。为此英特尔将重新平衡其半导体业务,计划将产业链布局的 50%放在美洲/欧洲,50%放在亚洲。

美再将 8 家中国公司列入实体清单。2 月 24 日,据外媒报道,美国商务部下设的工业和安全局当地时间 23 日宣布,把 93 个来自俄罗斯、中国、土耳其、阿联酋、吉尔吉斯斯坦、印度和韩国的实体列入"实体清单",其中 63 个来自俄罗斯,8 个来自中国,16 个来自土耳其。路透社称,美方决定对这些实体实施贸易限制。塔斯社 24 日报道称,中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇告诉该社,美国以涉俄为由,对中国企业实施更多单边制裁。这是典型的经济胁迫、单边主义霸凌行径。美方应立即纠正错误做法,停止遏制打压中国企业。

中国最后一座 12 英寸烂尾晶圆厂被接盘。2 月 24 日,"时代全芯存储技术股份有限公司"官微消息,经淮安市淮阴区人民法院裁定,时代芯存予以重组。重组后,华杰芯创集成电路制造(广东)有限公司将 100%持有时代芯存股权,该晶圆厂将转型成半导体代工厂,产品包括但不限于 DDIC、PMIC 以及高可靠存储芯片和 RF 芯片等。据悉,华芯杰创成立于2023 年 8 月,注册资本 20 亿元,大股东为中科先进(澳门)投资管理有限公司。华芯杰创淮安项目预计总投资 200 亿元,一期投资 50 亿元,计划三年内实现年产 20 万片的 12 英寸晶圆制造能力,五年内实现年产 60 万片。

美光推出紧凑封装型 UFS 4.0,助力下一代智能手机设计搭载更大容量电池。美光科技股份有限公司宣布开始送样增强版通用闪存(UFS)4.0 移动解决方案,该方案具有突破性专有固件功能并采用业界领先的紧凑型 UFS 封装(9 x 13mm)。基于先进的 232 层 3D NAND 技术,美光 UFS 4.0 解决方案可实现高达 1 TB 容量,其卓越性能和端到端技术创新将助力旗舰智能手机实现更快的响应速度和更灵敏的使用体验。

英伟达将华为列为"芯片竞争对手"。《环球时报》2月24日报道,美国芯片巨头英伟达在本周提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首次将华为认定为"最大竞争对手"。有分析认为,这表明将驱动新AI技术的先进制程芯片的全球格局正发生变化。报道称,英伟达指出,华为在供应图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)等用于AI的芯片领域,都可与业界竞争。在文件中,英伟达提及的其他竞争对手还包括英特尔、超微、博通、高通、亚马逊和微软。英伟达的报告中还写道,"新的竞争对手或竞争对手之间的联盟有可能出现,并获得重要的市场份额。"该公司还在报告中提到了中国科技公司阿里巴巴和百度,并将它们列为云服务领域的竞争对手。

台积电首座日本工厂开业。根据上海证券报报道,2月24日,台积电旗下日本先进半导体制造公司(JASM)的第一家工厂举行开幕典礼。这座位于日本熊本县的工厂是台积电在日本开设的首家工厂。台积电创办人张忠谋出席开幕典礼。日本首相岸田文雄通过视频宣布,日本政府决定支持JASM扩建计划。JASM于2021年由台积电与索尼半导体解决方案公司合资成立,第一家工厂于2022年4月开始建设,预计于2024年底开始生产。JASM建设的第二座晶圆厂计划于2024年底开工建设,2027年底投入运营。凭借这两个晶圆厂,JASM预计每月可提供超过10万片12英寸晶圆,将采用40nm、22/28nm、12/16nm、6/7nm制程工艺,为汽车、工业、消费和高性能计算应用代工相关产品。JASM的总投资将超过200亿美元。这两座晶圆厂预计将直接创造超过3400个高科技就业岗位。



分析师声明

本报告署名分析师在此声明:我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力,本报告所表述的 所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与,不与,也将不会与本报告中 的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定,本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附属机构(以下统称"天风证券")。未经天风证券事先书面授权,不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的,仅供我们的客户使用,天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考,不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估,并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求,必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果,天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期,天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。 天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下,天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易,也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此,投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突,投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
		买入	预期股价相对收益 20%以上
股票投资评级	自报告日后的6个月内,相对同期沪	增持	预期股价相对收益 10%-20%
放宗汉贞广纵	深 300 指数的涨跌幅	持有	预期股价相对收益-10%-10%
		卖出	预期股价相对收益-10%以下
		强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内,相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	中性	预期行业指数涨幅-5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅-5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心B	海南省海口市美兰区国兴大	上海市虹口区北外滩国际	深圳市福田区益田路 5033 号
座 11 层	道3号互联网金融大厦	客运中心 6号楼 4层	平安金融中心 71 楼
邮编: 100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编: 200086	邮编: 518000
邮箱: research@tfzq.com	邮编: 570102	电话: (8621)-65055515	电话: (86755)-23915663
	电话: (0898)-65365390	传真: (8621)-61069806	传真: (86755)-82571995
	邮箱: research@tfzq.com	邮箱: research@tfzq.com	邮箱: research@tfzq.com